

業 務

概覽

我們是誰

我們是一家受認可的fabless高速混合信號芯片設計公司，致力於升級智能終端、設備及AI應用的數據傳輸和視頻處理基礎設施。我們的可觸達市場主要包括兩個分部：互連芯片及智能視頻芯片。憑藉我們的三項基礎技術支柱，包括(i)高帶寬串行器／解串行器（「**SerDes**」）、(ii)高速接口協議處理與數據加密以及(iii)高清（「**高清**」）音視頻處理與顯示驅動技術，我們的產品能夠在計算、存儲和顯示單元之間實現高效數據處理、傳輸及格式轉換。該等應用包括智能視覺終端、智能車載、AR/VR設備以及AI與高性能計算（「**HPC**」）。透過整合高清視頻處理與顯示能力，以及智能感知與人機互動技術，我們的芯片建立了堅實的技術基礎，以支持未來端側AI驅動的應用。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，在視頻橋接芯片市場，我們為中國內地排名第一的fabless設計公司，市場份額為4.1%，而視頻橋接芯片是混合信號芯片的一個重要部分。

高清音視頻數據為連接實體世界與數字世界的重要橋樑。從沉浸式AR/VR體驗、自動駕駛中的全景感知，到創造多模態AI生成的內容，這些信息在異構處理單元(包括計算、儲存和顯示元件)之間的高速和穩定傳輸至關重要。此數據流程有賴於三項基礎技術支柱。我們近二十年來在這些核心技術上的研發（「**R&D**」）投入，支持我們在智能視覺時代下的產品不斷升級。

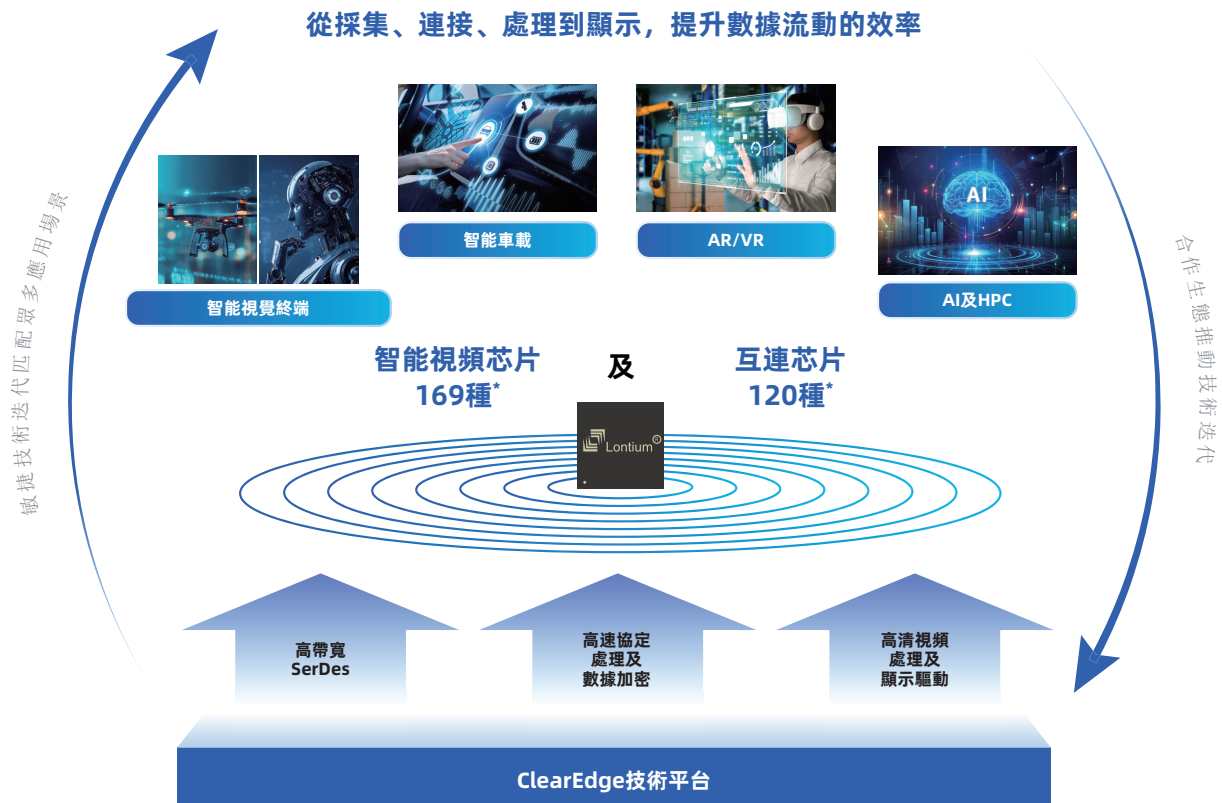
憑藉我們的高帶寬SerDes技術(用於高清音視頻信號傳輸與處理)，我們將擴展到更廣泛的互連芯片領域，包括PCIe/CXL/USB Retimer和Switch等關鍵互連元件的開發。此外，我們的解決方案解決多模態數據傳輸瓶頸以滿足對HPC和AI工作負載日益增長的需求。這包括：縱向擴展式架構(如GPU集群內部通訊)；橫向擴展式架構(如數據中心內部)；及跨系統架構(包括數據中心之間的連接性)，實現超低延遲、超高帶寬和高可靠性。

我們的產品與解決方案

以我們專有的ClearEdge技術平台為基礎，我們開發了芯片組合，通過包含採集、連接、處理及顯示能力的以芯片為基礎的端到端解決方案滿足主要應用場景的需求，包括：(i)智能視覺終端、(ii)智能車載、(iii) AR/VR以及(iv) AI & HPC。

業 務

截至2025年12月31日，我們的產品包括169種智能視頻芯片和120種互連芯片，可讓數據在異構系統中流通。我們致力於提升數據處理及傳輸效率，並為下一代智能交互建立技術基礎。我們建立了一個合作的生態系統，讓用戶應用回饋與策略夥伴關係(包括與全球半導體領導廠商的參考設計合作)成為技術持續迭代與解決方案強化的動力來源。下圖說明了我們的底層技術、產品矩陣和應用場景：



附註：截至2025年12月31日

智能視覺終端

智能視覺終端是我們芯片解決方案的主要應用場景。我們的智能視頻芯片和互連芯片可將光影、色彩和動態視覺細節從實體世界無損地傳輸至顯示裝置。這些芯片已廣泛應用於無人機、機器人、智能商業顯示器及智能視頻會議系統等智能視覺終端，並成為智能視覺技術發展和應用的重要推動力。我們的芯片組合支持廣泛的主流接口協議，包括HDMI、DP/eDP、USB-C、MIPI、LVDS、VGA及其他，實現多元化和小型化終端設計的靈活部署。

於2025年，我們來自此類應用產品的收入佔總收入的76.1%。自2023年至2025年，我們來自此類應用產品的收入的複合年增長率達27.7%。

智能車載

我們已將原本針對智能視覺終端所開發的核心技術能力，延伸至智能車載領域。我們在此應用領域的芯片解決方案涵蓋座艙域和駕駛域。

業 務

這些芯片實現多系統多屏幕互連，能高速、穩定地將大量傳感器數據(包括來自攝像頭、激光雷達以及毫米波雷達的數據)整合並傳輸至域控制器，以及從控制器至顯示裝置。因此，我們的產品是智能車載中數據融合、即時感知和智能交互的關鍵元件。截至2025年12月31日，我們已開發19顆通過AEC-Q100認證的車規級芯片。我們的汽車級產品和解決方案已被多家原始設備製造商(「OEM」)和一級供應商採用，服務於領先的歐洲、美國和中國汽車品牌。

於2025年，我們來自此類應用產品的收入佔總收入的15.7%。自2023年至2025年，我們來自此類應用產品的收入的複合年增長率達59.6%。

AR/VR

我們的芯片亦讓我們在提供AR/VR設備所需的沉浸式用戶體驗方面扮演關鍵驅動者，讓虛擬與真實環境得以融合。其支持高效的顯示信號傳輸，支持高分辨率(最高可達雙目8K)和高刷新率(最高可達120Hz)，同時維持極低延時。

透過與高通等領先的系統單晶片(「SoC」)廠商和索尼等顯示面板製造商開展參考設計合作，我們會調整芯片以確保與其平台可靠兼容。作為「SoC+芯片+面板」生態系統關鍵的高速接口橋樑，我們的芯片已集成至索尼AR顯示面板參考設計中，彰顯了我們在低延遲傳輸方面的技術領先地位。我們先進的芯片解決方案已被全球AR/VR品牌如雷鳥、Rokid、XREAL及位於美國的全球消費性MR頭戴式顯示市場領導者採用。

於2025年，我們來自此類應用產品的收入佔總收入的6.4%。自2023年至2025年，我們來自此類應用產品的收入的複合年增長率達27.6%。

AI & HPC

我們正擴展至AI & HPC領域，並加速這些應用產品的商業化。我們已開發支持PCIe的SATA主控芯片，以提升計算與儲存單元之間的數據傳輸效率。此外，我們的多項高價值產品已進入流片階段，例如HDMI2.1轉PCIe4.0芯片，以無損採集和傳輸高分辨率、高刷新率的視頻信號而設計。該等芯片可實現先進的影像採集、渲染、處理和識別功能，滿足AI視覺和計算系統中專業級的信號轉換需求。

此外，我們的PCIe/CXL/USB Retimer及Switch，包括與CXL2.0兼容的PCIe5.0 Retimer正在開發，是AI & HPC基礎架構的關鍵推動力，支持GPU與CPU之間的超高速互連，可解決信號完整性的挑戰以及因計算需求日益增加而產生的傳輸瓶頸。

業 務

下表載列按產品應用場景劃分，我們於往績記錄期產生的收入，以絕對金額及佔我們總收入的百分比列示。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
智能視覺終端	265,069	82.0	353,449	75.8	432,357	76.1
智能車載	34,954	10.8	84,033	18.0	89,059	15.7
AR/VR	22,366	6.9	22,715	4.9	36,387	6.4
AI & HPC	758	0.3	5,806	1.3	10,401	1.8
總計	323,147	100.0	466,003	100.0	568,204	100.0

就市場規模而言，全球半導體芯片市場持續擴展，主要是由於各種應用中對高性能電子系統的需求不斷上升所推動。根據弗若斯特沙利文的資料，在整體半導體芯片行業中，智能視頻芯片和互連芯片是兩個重要的領域，在現代電子系統中發揮著基本功能。智能視頻芯片是顯示設備中的關鍵半導體組件，能夠處理、轉換和傳輸視頻信號，以支持圖像呈現並增強視覺性能。互連芯片作為電子系統的數據傳輸促成者，可在處理器、記憶體、儲存及其他系統組件之間實現高速可靠的數據傳輸。就按收入計算的市場規模而言，2025年智能視頻芯片和互連芯片市場分別佔整體半導體芯片行業的2.2%和3.2%。預計到2030年，智能視頻芯片和互連芯片的市場規模將分別達到人民幣1,431億元和人民幣4,907億元，複合年增長率分別為6.4%和23.1%。此外，視頻橋接芯片市場是智能視頻芯片市場中增長最快的細分市場。2025年，視頻橋接芯片市場佔智能視頻芯片市場的10.4%，預計到2030年，全球視頻橋接芯片市場規模將達到人民幣221億元，複合年增長率為15.3%。憑藉我們強大的品牌影響力、市場領導地位、全面的產品覆蓋和成熟的技術創新能力，我們相信我們已做好準備，把握可觸達市場的增長機遇，進一步鞏固我們的行業領導地位。

我們的技術實力和行業生態

我們已經過數十年的研發投入建立穩固的技術平台(ClearEdge)和生態系統護城河，並在廣泛的應用領域獲得客戶的廣泛認可。有關ClearEdge的詳情，請參閱「— 我們的核心技術」。

我們對核心技術採取全棧自研的策略，能夠嚴格控制創新和產品品質。此外，我們持續深化與全球半導體領導廠商的參考設計合作，例如英偉達、高通及英特爾，而我們的合作方通常會提供系統的技術藍圖，其中包含需由設計夥伴(如我們)進行強化或修改的系統元件。這些合作以項目為基礎、屬非排他性質，且不涉及知識產權的共同開發或我們及相關對手方的合約安排。根據弗若斯特沙利文的資料，該等合作安排符合一般市場慣例。我們通常擁有在這些合作當中提供或開發的芯片的知識產權。通過這些合作，我們的芯片被選用及集成至合作夥伴的官方平台解決方案中，有助於終端客戶採用，並鞏固我們在更廣泛、可擴展的技術生態系統中的地位。所有芯片開發均由我們獨立完成，我們所開發芯片的知識產權均歸我們所有。有關我們的參考設計合作模式的詳情，請參閱「— 廣泛營運及與產業生態系統領導者緊密合作」。

業 務

我們亦定期與行業價值鏈中的主要參與者進行技術對話，以確保我們的技術設計和產品開發符合不斷變化的市場需求。此外，我們與全球領先的集成電路（「IC」）晶圓廠及封裝測試服務提供商緊密合作，並建立涵蓋國內及國際來源的雙軌供應鏈體系，以確保穩定及彈性的產品交付。

市場機遇

AI技術的飛速發展正推動全球數據量呈指數級增長。隨著AI模型持續演進並廣泛採用，其應用場景不斷擴大——從雲端基礎架構到端側AI。這種轉變對傳感器、處理器和計算平台的超低延遲、超高帶寬及高可靠互連提出了前所未有的需求。各式各樣的高速傳輸協議正快速發展與迭代，以滿足該等需求。

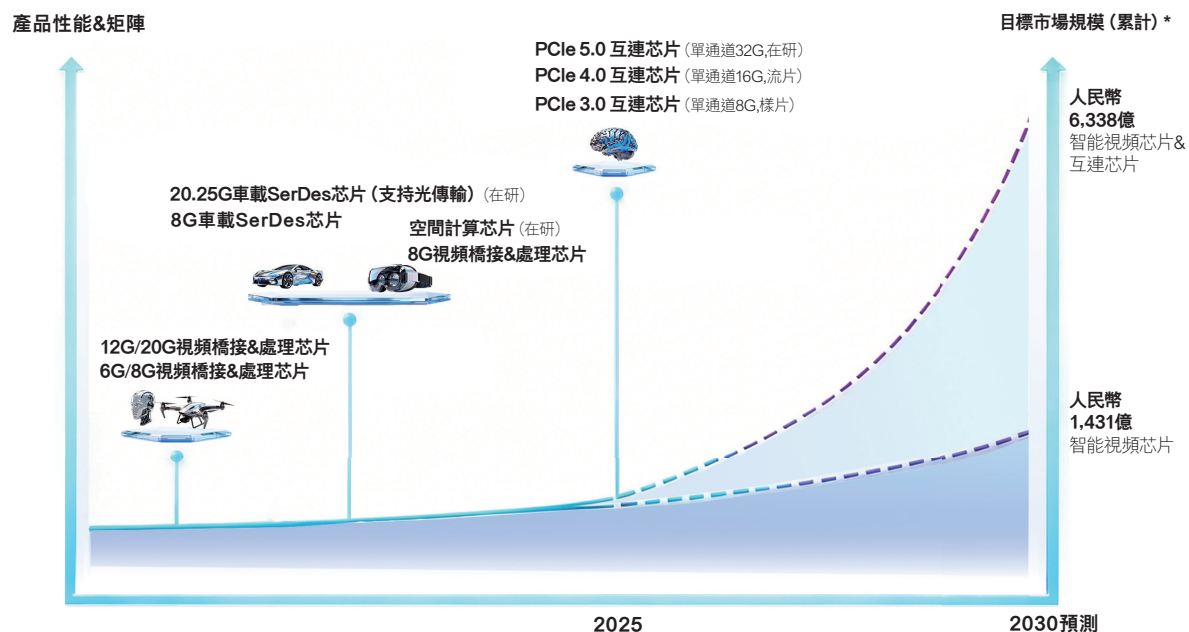
在雲端協同的時代下，我們的智能視頻芯片與互連芯片透過在兩個關鍵層面實現端側智能應用、支持高效AI基礎設施，以及連接物理與數字世界，滿足此需求：

- AI基礎設施的廣泛部署和端側AI應用的普及，將增加對我們的高速混合信號芯片的需求；及
- AI系統不斷提高的技術要求——尤其是在傳輸速度和功率效能方面——將推動我們的產品不斷升級，提升其跨代價值和差異化競爭力。

這些趨勢為我們的長期業務增長和市場擴張提供強大且可持續的動力。根據弗若斯特沙利文的資料：

- 智能視頻芯片的市場規模預計將從2026年的人民幣1,118億元增長至2030年的人民幣1,431億元，複合年增長率為6.4%。
- 互連芯片的市場規模預計將由2026年的人民幣2,134億元增長至2030年的人民幣4,907億元，複合年增長率為23.1%。

下圖概述我們擴展至多個應用場景的時間表，以及我們正蓄勢待發以把握的市場機遇。



附註：根據弗若斯特沙利文的資料

業 務

- **智能視覺終端**：AI正在將智能視覺終端從「信息呈現」或「被動執行」設備轉變為具備環境感知、多模態交互和自主決策能力的智能節點。作為打通物理世界與數字空間的基礎設施，該等終端正推動我們芯片直接處理的高質量音視頻數據的採集及傳輸需求增長。根據弗若斯特沙利文的資料，用於智能視覺終端的智能視頻芯片市場規模預計從2026年的人民幣747億元增長至2030年的人民幣842億元，複合年增長率為3.0%。
- **智能車載**：攝像頭、激光雷達和毫米波雷達等各種傳感器，以及域控制器、顯示屏之間，都需要以高穩定性及實時性完成海量多模態數據的時間同步、精確融合與穩定傳輸。如此嚴苛的實時性與可靠性要求直接推動智能視頻芯片和互連芯片(作為關鍵的助推器)的需求。根據弗若斯特沙利文的資料，用於智能車載的智能視頻芯片市場規模預計將從2026年的人民幣329億元增長至2030年的人民幣464億元，複合年增長率為8.9%。
- **AR/VR**：為向消費者提供極致沉浸體驗，AR/VR設備在沉浸式顯示、空間交互與實時渲染方面不斷改進，這將直接驅動智能視頻芯片和互連芯片的持續演進。根據弗若斯特沙利文的資料，用於AR/VR的智能視頻芯片市場規模預計將從2026年的人民幣42億元增長至2030年的人民幣126億元，複合年增長率為31.8%。
- **AI & HPC**：為滿足大規模AI訓練與推理對數據吞吐量和延遲的嚴苛要求，底層硬件需支持PCIe5.0/6.0、CXL2.0/3.0等高速協議。因此，對PCIe/CXL Retimer及Switch的需求大幅增長。根據弗若斯特沙利文的資料，AI運力芯片市場規模預計從2026年的人民幣2,023億元增長至2030年的人民幣4,742億元，複合年增長率為23.7%。

優勢

受認可的高速混合信號芯片設計公司

我們以近二十年的研發投入與產品開發，在高速混合信號芯片產業中確立了受認可的地位。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，在視頻橋接芯片市場，我們為中國內地排名第一的fabless設計公司，持有市場份額4.1%，而視頻橋接芯片是混合信號芯片的一個重要部分。憑藉我們強大的研發能力及前瞻性的產業生態系統，我們為智能視覺終端、智能車載、AR/VR及AI & HPC等應用領域的客戶提供服務，具備與主要國際行業參與者對標的能力。

自成立以來，我們不斷提升研發能力，並擴大產品的應用範圍。於2008年，我們推出首款HDMI1.3產品，標誌著我們開展在高速接口技術領域的旅程。於2020年，我們進入智能車載領域，與業界領導廠商、歐洲知名高端OEM，以及中國知名的新能源和傳統汽車製造商建立夥伴關係。於2023年，我們透過與索尼及其他生態系統夥伴的合作，在AR/VR領域取得了重大進展。於2025年，我們開始拓展AI & HPC市場，推進新PCIe和DP接口產品的開發，單通道數據傳輸率最高可達20Gbps。

隨著AI模型持續演進並廣泛採用，其應用情境從雲端基礎架構擴展至端側AI。這轉變正在對傳感器、處理器和AI運算平台的超低延遲、超高帶寬和高度可靠互連產生前所未有的需求。

業 務

專有自研的底層技術平台

我們已建立專有技術平台ClearEdge，成為我們技術領先的基礎。ClearEdge集成了三個核心技術支柱：高帶寬 SerDes、高速協議處理及數據加密，以及高清視頻處理及顯示驅動。此平台有100多個芯片開發項目的設計、數據和專業技術，可適配不同晶圓廠的電路設計，並讓設計能力在多個應用場景中快速重複使用。有關詳情，請參閱「—我們的核心技術」。

高帶寬SerDes技術實現先進電子系統中的高速數據傳輸。我們在SerDes方面的持續研發努力為現有及下一代產品提供支持。例如，我們獨立開發的SerDes技術一般可支持：(i) HDMI2.1，具備12Gbps的單通道傳輸速率，適用於8K@60Hz UHD視頻；(ii) ADP，為智能車載系統提供高達8.1Gbps的傳輸率；及(iii) DP2.1，每通道達20Gbps，適用於AR/VR應用中的新一代高分辨率、高刷新率顯示器。我們亦正在研發SerDes技術，支持每通道最多32Gbps，適用於PCIe5.0等協議。我們的SerDes解決方案具有高速、低延遲、高可靠性和低BER的特點，使其適用於數據密集型AI訓練和推理系統。

我們在接口協議處理和數據加密方面的能力支持主流傳輸協議，包括HDMI、DP/eDP、USB、MIPI、LVDS、VGA、PCIe和SATA。我們的解決方案提供穩定、高效率的信號處理，可滿足智能終端與邊緣設備多樣化的需求。在PCIe領域，我們已驗證PCIe轉SATA和HDMI轉PCIe等具備經測試領先效能的關鍵芯片解決方案，其對於AI推理和訓練環境中的高吞吐量互連是不可或缺的。此外，為確保數據安全性，我們芯片的發射端與接收端內建了數據加密與解密技術模塊，確保僅允許授權設備解密並使用受保護內容，防止未經授權的複製、截取和使用。

我們的視頻處理及顯示驅動技術支持從視頻輸入到輸出的整個流程，支持高達4K/8K的超高清格式，並具有低延遲和低耗電的特性。我們獨立開發了LPDDR4、DDR3和PSRAM的記憶體控制器技術，以確保高效、穩定和即時的視頻處理，包括影像增強、顯示控制、多屏幕處理與場景適應。

我們所有量產的芯片均以自研IP為基礎。我們建立了一個高度可重複使用的IP庫，可在不同的產品和應用中實現有效的擴展性，並讓我們可加快產品開發、迅速回應客戶需求和最大限度減少使用第三方IP。

針對高增長應用場景的產品組合

我們已構建包含200多款芯片型號的產品組合，涵蓋從基本功能芯片到先進系統級解決方案，使我們能夠滿足各種應用的技術和效能需求，例如智能視覺終端、智能車載、AR/VR和AI & HPC。

業 務

下圖說明我們的產品演進過程及關鍵技術里程碑：



我們的芯片專為滿足感知和顯示端點對於高清、高速信號處理和多裝置互連性日益增加的需求而設計。我們的解決方案支持主流信號協議之間的轉換，集成數據加密與解密、視頻處理與壓縮、色彩增強和顯示控制等功能。請見「我們的產品」及「我們的解決方案與應用領域」。

我們是智能視覺終端領域的受認可參與者。在汽車領域，我們於截至2025年12月31日已完成19款芯片型號的AEC-Q100認證，我們的產品已成功集成至全球主要汽車OEM的供應鏈中。我們為支持長距離、超高清視頻傳輸而開發的車載SerDes芯片，目前已延伸至攝像雲台和無人機等新應用場景。在AR/VR領域，我們的解決方案已被全球領先品牌的多款量產機型所採用。此外，我們已成功開發支持PCIe的SATA主控芯片並正開發PCIe/CXL/USB Retimer，以AI PC和服務器為目標。

廣泛營運及與產業生態系統領導者緊密合作

我們的廣泛營運受到與產業生態系統領導者的緊密合作所支持，我們的技術能力和產品性能贏得了國內及全球領先客戶和生態系統合作夥伴的廣泛認可。

我們與英偉達、高通及英特爾等全球領先的芯片廠商緊密合作。透過參考設計合作夥伴關係，我們已成功將我們的芯片集成至其官方平台解決方案中。我們的合作通常遵循兩種模式，即適配模式及定向創新模式。在適配模式下，我們提供我們的現有芯片以補充合作方的SoC，解決關鍵連接缺口，例如使不具備內置HDMI功能的處理器能夠輸出高清影像。在定向創新模式下，我們通過對標合作方的技術規格，利用專有技術平台開發面向更廣泛市場的新芯片，例如創建高規格HDMI 2.1轉PCIe 4.0橋接器，以滿足AI/HPC應用的連接需求。與市場慣例一致，我們的參考設計合作關係通常不涉

業 務

及我們與相關對手方之間的合約安排。在這兩種模式下，我們擁有所提供或開發的芯片的知識產權，並可獨立將芯片商業化。這些經市場驗證的解決方案幫助我們的客戶大幅縮短研發週期，提高集成效率。我們亦就產業趨勢進行共同研究，並與主要市場參與者參與新興解決方案的共同調試，以確保我們的產品能持續符合不斷演進的客戶需求。

高價值忠實客戶池

此外，我們建立了忠實的客戶生態系統，其特點是規模大且參與度高。我們的策略夥伴關係涵蓋核心應用領域的領導品牌和製造商，例如智能視覺終端、智能車載和AR/VR系統。

下圖為我們在智能視覺終端、智能車載及AR/VR領域的終端客戶代表：

應用領域	終端客戶代表 ⁽¹⁾
智能視覺終端	視源股份、全球網絡領導者、知名週邊設備製造商、全球PC巨頭、頂尖電子合同製造商
智能車載	歐洲知名高端汽車製造商、國際一級供應商、中國領先的汽車品牌
AR/VR	雷鳥、Rokid、XREAL、位於美國的全球消費性頭戴式MR設備市場領導者

附註：按字母順序列示。

高效靈活的雙軌供應體系

我們與全球領先的晶圓代工廠、封裝測試服務供應商保持緊密的合作關係，以確保提供符合全球客戶嚴格要求的高品質產品。為了進一步加強供應鏈的安全性和靈活性，我們建立了雙軌供應系統，以有效地滿足不同地區客戶的多樣化需求。我們亦與上游合作夥伴進行技術交流和策略合作，分享產業洞察力，共同推動晶圓製造、封裝測試技術的創新，以快速回應市場動態和客戶需求。

富有遠見且經驗豐富的管理團隊

我們的管理團隊由富有遠見且經驗豐富的領導者組成，他們在高速混合信號芯片設計領域擁有深厚的專業知識。我們的創始人FENG CHEN(陳峰)先生曾在英特爾擔任技術領導職務，專門從事高速CPU及I/O芯片設計。憑藉其對全球半導體趨勢和產業動態的深刻洞察，陳先生塑造了我們的研發架構。

受陳先生對產業的遠見啟發，我們的管理團隊實施技術迭代及場景拓展戰略。我們最初專注於高清視頻芯片，支持HDMI、DP及相關協議的高清視頻芯片，在國內市場建立地位。我們其後擴展到智能車載系統和AR/VR，並於近期開始AI及HPC應用場景的PCIe/CXL、SATA、USB、端側運算及即時互動技術研發。這種以能力為導向的前瞻性策略，讓我們能夠在多個產業週期中保持優勢。

業 務

戰略

加強研發投入，支持核心技術及產品的持續發展

升級ClearEdge平台，擴大專有IP

我們持續擴大自主研發的IP資源基礎，優化ClearEdge平台，並著重提升其在各種應用上的可擴展性。

推動關鍵新興技術的創新

我們正深化在三個高成長垂直市場的地位：

- 在智能車載領域，我們正在推進SerDes技術，並已從第一代量產ADP協議發展至第二代ADP解決方案。這項次世代技術支持高正向單通道傳輸速率及反向傳輸速率，並同時兼容於電氣與光學傳輸。
- 在AR/VR領域，我們專注於空間計算技術，在視頻採集與數據融合、高效能視頻處理以及端側邊緣運算方面建立核心競爭力。結合高速接口轉換技術，其可支持高精度環境感知和3D重構，實現身歷其境的智能AR/VR體驗。
- 在AI & HPC領域，我們持續投資於高速傳輸協議的研發，包括PCIe/CXL、SATA和USB，以滿足AI訓練、推理和邊緣運算情境中不斷增加的數據吞吐量需求。

推進半導體工藝技術

我們透過深化與領先晶圓代工廠的合作，加速相對先進工藝節點的開發，目標是持續提升整合密度、降低功耗、改善效能，並降低整體生產成本。

瞄準高價值及高用量應用場景，持續豐富我們的產品矩陣，實現更高收入增長率

憑藉我們的技術專長，我們將瞄準智能車載、AR/VR和AI & HPC等新興高價值智能場景，持續豐富產品矩陣，實現更高收入增長率，提升我們的市場滲透率。

- **智能車載領域：**我們成立了汽車芯片和系統解決方案事業部，未來將持續拓展車載娛樂系統、座艙顯示、HUD、ADAS視頻採集和傳輸SerDes、多路顯示傳輸SerDes、車規級面板驅動、音頻傳輸SerDes以及麥克風和揚聲器等領域的車規級芯片及解決方案。
- **AR/VR領域：**我們將不斷提高產品的性能、集成度及功耗管理水平，滿足AR/VR設備不斷演進的低延時傳輸、超低功耗及小型化需求；同步推進端側採集及空間計算芯片研發，滿足「所見即所得」人機交互的極低計算延遲要求。
- **AI & HPC領域：**我們將聚焦端側AI與高性能傳輸場景，持續推進PCIe/CXL、SATA、USB等高速協議芯片的研發與迭代。

業 務

擴展市場影響力，建立可擴充的營運系統

國際化是我們發展戰略的核心支柱，而全球資源整合則是建立全面且可擴充的運營體系的重要推動力。我們戰略的主要內容包括：

- **海外研發中心規劃**：我們的目標是在主要國際市場策略性地建立研發中心。此舉將促進本地化創新，讓我們能夠調整產品以滿足不同的市場需求，並善用區域性的專業知識。
- **加強與國際芯片製造商的合作關係**：在現有與國際主要芯片廠商合作的基礎上，我們將繼續擴大全球市場的合作關係生態系統。
- **優化全球客戶服務網絡**：我們致力於優化全球客戶服務網絡，確保快速回應。我們旨在透過簡化流程，提升客戶滿意度，建立長期忠誠度。
- **雙軌供應體系發展**：我們將持續建立結合國內外晶圓廠的雙軌供應系統。這包括深化與全球領先晶圓製造商和封裝測試公司的策略合作，確保我們的供應鏈穩健、靈活，並能滿足不斷增加的需求。

加強人才發展，賦能科研及增長

我們的目標是打造具備國際視野與強大系統工程能力的卓越團隊。隨著我們業務的持續拓展，我們愈發重視人才的戰略價值。我們將聚焦高精尖人才引進，特別是強化研發團隊，通過拓展專家推薦網絡及校園招聘，多渠道精準觸達頂尖人才。我們亦將持續推進人才激勵計劃，激發員工的潛力，構建高效、活力充沛的工作環境，培養具有科技創造力和團隊精神的研發人才，為我們的長遠發展打造堅實的人才護城河。

探索戰略投資併購機會

為增強我們的技術優勢，我們探索策略性投資與併購機會，聚焦於智能車載芯片、顯示驅動芯片及AI運力芯片等關鍵領域。通過嚴格篩選擁有深厚技術專長和獨特競爭力的優質目標，我們的目標是進一步擴大我們的技術和產品供應。

我們的產品

截至2025年12月31日，我們的產品組合涵蓋169款智能視頻芯片和120款互連芯片。我們的混合信號產品融合物理與數字世界，提供包含採集、連接、處理及顯示功能的端到端解決方案，滿足智能視覺時代對於超低延遲、超高帶寬及高可靠數據傳輸及智能交互不斷增加的需求。

業 務

下表載列我們於往績記錄期產生的收入，按我們提供的產品劃分：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
(以千元計，百分比除外)						
智能視頻芯片	269,543	83.4	381,387	81.8	473,109	83.3
互連芯片	52,154	16.1	73,287	15.7	93,331	16.4
其他 ⁽¹⁾	1,450	0.5	11,329	2.5	1,764	0.3
總計	323,147	100.0	466,003	100.0	568,204	100.0

附註：

- (1) 「其他」主要包括技術服務和輔助零件所得收入。技術服務包括技術授權及定制芯片設計服務。輔助元件包括印刷電路板、安全鑰匙及其他輔助芯片。

下表載列我們於所示期間主要產品類別的銷量及平均售價（「平均售價」）。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價
	千顆	人民幣元	千顆	人民幣元	千顆	人民幣元
智能視頻芯片	17,542	15.4	25,584	14.9	35,816	13.2
互連芯片	6,953	7.5	8,883	8.3	11,236	8.3
其他 ⁽¹⁾	722	2.0	790	14.3	686	2.6
總計	25,217	12.8	35,256	13.2	47,738	11.9

附註：「其他」主要包括技術服務。

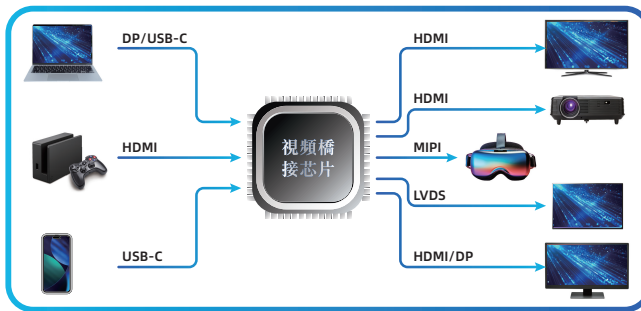
我們的總銷量由2023年的約25.2百萬顆增至2025年的47.7百萬顆，主要由於我們提升芯片性能以擴展產品組合，同時優化銷售策略，擴大客戶覆蓋範圍。

智能視頻芯片的平均售價由2023年的每顆人民幣15.4元減少至2025年的每顆人民幣13.2元，主要由於銷售成本及銷售價格較低的較成熟產品型號佔較高比例。此類成本優化型芯片型號的銷量由2023年的約110,000顆增加至2025年的約6.9百萬顆。透過優化芯片架構及減少若干非核心電路元件，並同時維持及提升芯片效能，我們增加了每片晶圓所生產的芯片數量，並提高了晶圓利用率。由此降低的單位製造成本使我們能夠向客戶提供更具競爭力的價格，導致平均銷售價格下降。互連芯片的平均售價於往績記錄期在每顆人民幣7.5元至人民幣8.3元之間波動，主要反映產品組合發生變化。其他產品的平均售價於往績記錄期在每顆人民幣2.0元至人民幣14.3元之間波動，主要反映各期間提供的技術服務有不同組合及複雜程度。其他於2024年的平均售價大幅增加，主要是由於確認技術授權及客製芯片設計服務的收入所致，有關收入以項目方式產生，與產品銷售並無直接關係。有關主要產品類別的毛利與毛利率明細，請參閱「財務資料—經營業績—毛利及毛利率」。

業務

智能視頻芯片

我們的智能視頻芯片包括視頻橋接芯片和視頻處理芯片，使智能系統能夠以超乎想像的清晰度採集、連接、處理和顯示視覺數據。作為多功能轉換器和影像品質引擎，我們的產品可解決視覺數據來源（例如攝像頭或SoC）與顯示終端（例如屏幕或監視器）之間的不兼容。



視頻橋接芯片

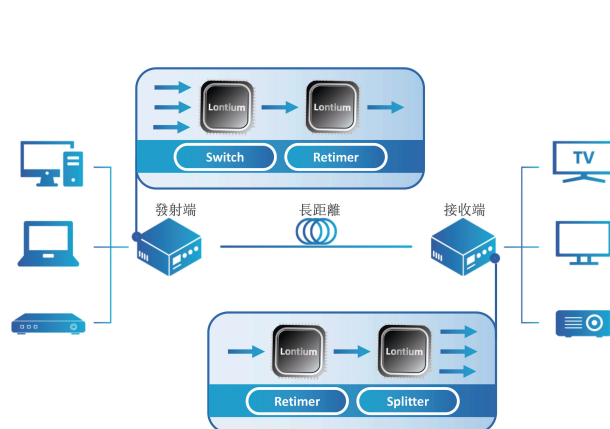


視頻處理芯片

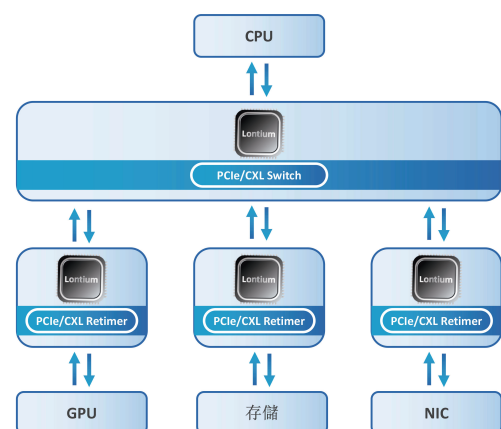
- **視頻橋接芯片**：這些芯片在不同標準之間轉換信號，包括DP、HDMI及MIPI，讓不同協議的裝置能立即溝通。我們的橋接芯片能確保高帶寬的視頻傳輸，傳輸速率高達20Gbps，並具備超低延遲與廣泛的通訊協議兼容性。
- **視頻處理芯片**：這些芯片可透過影像縮放、色彩校正和降噪等提升視覺體驗。這些芯片支持多視窗顯示器、8K超高清分辨率以及高達240Hz的高刷新率輸出等功能，以確保呈現清晰、流暢且色彩準確的最終影像。

互連芯片

我們的互連芯片主要包括高速信號互連芯片及AI運力芯片，可確保海量數據高效可靠地跨系統傳輸。隨著數據中心和AI & HPC平台的擴充，信號在距離上的衰減及大規模數據切換成為瓶頸，而芯片乃專為解決這些挑戰而設計。



高速信號互連芯片



AI運力芯片

業 務

- **高速信號互連芯片**：這些芯片(包括中繼器、切換器、分配器以及矩陣芯片)為顯示生態系統的信號增強器和流量控制器。運用我們專有的信號調節技術，這些芯片可在長距離和複雜的電路板上淨化、放大和路由信號，實現多視窗設定以及確保AI驅動的智能視覺終端、AR/VR設備和智能車載顯示的高保真傳輸。
- **AI運力芯片**：這些芯片(例如高速PCIe/CXL/USB Retimer及Switch和協議橋接)可支持AI訓練和高效能運算所需的分散式拓撲。這些芯片有助於儲存單元與CPU和GPU等運算單元之間的高效數據交換。這些在研芯片支持每通道高達32GT/s的傳輸速率，確保PCIe 4.0/5.0 (CXL2.0兼容)和SATA等關鍵接口的數據完整性。

產品生命週期及交付週期

我們的產品遵循底層接口協議的技術升級週期。在智能視頻芯片方面，我們提供的產品涵蓋從HDMI1.4(單通道3.4Gbps，支持1080p)到HDMI2.1(單通道12Gbps，支持8K)的多代HDMI，以及從DP1.2(單通道2.7Gbps)到DP2.1(單通道20Gbps)的多代DisplayPort。在互連芯片方面，我們提供支持3Gbps至8Gbps數據速率的產品。鑑於不同終端市場採用新協議的速度各異，我們同時維持多代產品量產。於往績記錄期，一般而言，新產品的開發週期約為設計200天、製造120天及驗證150天。進入量產後，從下單到交付的平均時間通常介於25至50天。產品定價因產品世代及規格而異，規格越高的產品通常價格越高。請參閱「—銷售、營銷及經銷、定價」。

我們的解決方案與應用領域

我們的芯片可用於多種應用場景。舉例來說，視頻橋接芯片有助於智能視覺終端與會議攝像頭進行連接，而相同的底層技術支持智能車載連接信息娛樂系統與後座顯示器。同樣地，在AI服務器中確保信號完整性的互連芯片也可於複雜的AR/VR系統中維持穩定的高速數據流。其具有採集、連接、處理和顯示的基本能力，可在目標市場加強我們的解決方案。我們的產品已廣泛應用於智能視覺終端、智能車載及AR/VR設備領域，而我們的重點是在AI & HPC應用領域。

智能視覺終端

智能視覺終端是我們最大的終端應用市場。我們的產品已被多家國際知名企業採用，廣泛應用於無人機、機器人、智能商業顯示器和視頻會議系統等領域的量產中。

業 務

下圖載列智能視覺終端中我們產品的多個典型應用場景概覽，以供說明：



我們的智能視覺終端芯片具備以下競爭優勢：

- **全面協議支持：**我們的產品支持主要行業協議，包括HDMI、DP/eDP、USB-C、MIPI、LVDS和VGA，為商顯及配件市場提供靈活多樣的部署方案；
- **高數據速率與高分辨率：**我們的產品支持高達8K@60Hz的分辨率，並集成DSC壓縮與解壓縮技術。此外，我們的DP/USB-C產品支持多流傳輸(MST)，可通過單一鏈路傳輸多個顯示流，從而降低系統級設計的複雜性；
- **單芯片解決方案：**我們擴展產品組合，為典型應用提供單芯片解決方案，簡化客戶系統設計並降低設備成本；
- **低功耗與高穩定性：**通過持續優化設計和精細化電源域劃分，我們降低芯片級功耗並提升整體系統穩定性，從而延長便攜設備的電池續航時間；及
- **多種應用專用產品：**我們也提供針對特定市場設計的若干產品，其特點包括體積小、功耗低、熱輸出低、分辨率高、刷新率高及色深高，特別適用於醫用內窺鏡和工業無損檢測等應用領域。

案例研究：智能視頻會議系統的HDMI-MIPI協議轉換

一家全球頂尖個人電腦及企業解決方案供應商尋求在具備智能音頻和面部識別等先進功能的高通移動SoC平台上建立新型智能視頻會議系統時，他們遇到了關鍵的連接瓶頸。核心處理器以MIPI標準運作，但實際世界的生態系統(從筆記本電腦等視頻和音頻信號源到大型商用屏幕等顯示器)主要依賴HDMI。這種錯配造成了對能夠在這些不兼容協議之間進行轉換的高效能接口橋接IC的迫切需求。

我們提供的解決方案附有完全自主開發的IP，在架構層面上優化效能與功耗。我們全面的HDMI-MIPI轉換產品組合支持從HDMI1.4到先進的HDMI2.1等各種標準。我們的HDMI-MIPI轉換產品已適配高通平台，並整合至高通的官方參考設計平台。所有芯片開

業 務

發均由我們獨立完成。此合作可使下游客戶加快開發週期，並獲得高通與本公司的技術支持。該解決方案亦已擴展至附有英特爾CPU平台的迷你電腦產品。

智能車載

我們憑藉於智能視覺終端應用領域積累的技術實力，成功拓展至智能車載領域。我們的高速混合信號芯片應用於座艙及駕駛領域，能高速穩定地整合及傳輸來自攝像頭、激光雷達及毫米波雷達等各種傳感器的大量數據至域控制器及顯示器。

於典型智能車載架構中，我們的串行器芯片將來自攝像頭及其他裝置的傳感器數據傳輸至域控制器，而我們的解串行器芯片則將域控制器處理後的視頻信號傳送至座艙顯示。我們的視頻橋接芯片則進一步實現域控制器與車載顯示系統之間的協議轉換功能。

我們的智能車載芯片有以下競爭優勢：

- **全面的車規級認證：**截至2025年12月31日，我們已有19款芯片通過AEC-Q100認證，並有數款芯片正在進行認證測試。該等產品涵蓋人機交互及顯示驅動等關鍵功能；
- **豐富的產品組合：**我們的智能車載芯片系列提供不同版本及規格，能應對客戶的多元需求，並在不同汽車平台上提供具成本競爭力的解決方案；
- **獲主要整車廠與一級供應商用於量產：**多款產品已被領先汽車品牌用於汽車量產。我們的解決方案亦被主要的一級供應商，例如國內外的汽車電子領導廠商，採納為標準配置，顯示我們的產品經實證的可靠性；
- **具自研ADP協議的車用SerDes芯片組：**我們的SerDes芯片組為汽車應用量身打造，通過整合我們自研的ADP協議，可實現車載攝像頭與顯示器信號的長距離及無損超低延遲傳輸。產品同時支持菊花鏈拓撲架構與多路融合技術，簡化車內線路佈局，降低線束成本，並提升系統設計靈活性；及
- **研發中的次世代技術：**我們正開發新一代ADP Link-II技術，支持前向通道數據速率高達20.25Gbps，反向通道數據速率則可達1.08Gbps。

案例研究：車載智能座艙娛樂系統的HDMI-MIPI轉換

一家頂尖車載電子產品供應商開發的高級車用智能座艙娛樂系統，使用高通SoC及晶晨SoC平台。該系統需要HDMI2.0輸入至CSI-2的轉換芯片，以(i)連接電腦或遊戲主機等外部HDMI設備，供投影至後座顯示器；及(ii)將晶晨SoC的HDMI輸出信號連接至高通SoC，用於內部屏幕投影功能。此外，車載攝像頭模組的CSI-2輸出需轉換至HDMI以供晶晨SoC處理。該解決方案必須支持高達4K60分辨率、HDCP2.3規範，並符合車規級標準。

業 務

我們提供HDMI轉MIPI及MIPI轉HDMI芯片，為行業首創支持HDMI2.0 4K60及HDCP2.3並同時通過AEC-Q100汽車認證。兩款芯片均已證實與高通平台具兼容性。該解決方案已成功在車用智能座艙系統中量產。相同零部件亦已應用於航海電子產品。

AR/VR

我們的芯片在AR/VR設備中連接虛擬與現實世界，能將主處理器生成的高清晰度、高刷新率視覺數據，以超低延遲傳輸至微型顯示器，確保顯示流暢無撕裂，營造無邊界的沉浸感。

於典型AR/VR應用中，我們的芯片在信號鏈中扮演多重角色。針對VR頭戴裝置，我們的USB-C轉MIPI/LVDS轉換芯片接收來自主機裝置的視頻信號，並將其轉換為與微型顯示器相容的格式。我們的空間計算SoC處理空間交互功能，包含六自由度追蹤、手勢辨識及眼球追蹤。針對AR眼鏡，我們的MIPI轉USB-C以及HDMI轉USB-C芯片則將裝置擷取的視覺數據傳送至主機進行處理。

我們用於AR/VR的芯片有以下競爭優勢：

- **獲領先AR/VR設備生產商採用：**我們與雷鳥、Rokid及XREAL等領先市場參與者以及美國一家消費者MR眼鏡全球市場領先者合作。該等生產商的多款量產型號已採用我們的芯片，實現高分辨率(最高雙眼8K)、高刷新率(最高120Hz)及超低延遲的顯示性能；
- **先進顯示系統的全面功能：**我們的芯片支持DP1.4、DSC壓縮／解壓縮、HDCP解密、3D顯示及OSD功能。同時整合USB-C PD控制器和LPDDR4記憶體，以強化影像縮放與幀率轉換效能；
- **為可穿戴設備優化的緊湊設計：**透過高集成單芯片架構與精細的多電源域優化，我們的芯片顯著降低功耗與芯片尺寸，滿足AR眼鏡嚴格的輕薄化需求；及
- **深度生態系統合作：**我們與索尼及高通等主要全球技術公司合作，以共同建立「SoC+芯片組+面板」的生態系統，鞏固我們在下一代可穿戴設備中的地位。

案例研究：AR眼鏡的USB-C/DP轉MIPI/LVDS

一個模組化AR眼鏡系統需要以芯片橋接外部來源與眼鏡之間的視頻傳輸。當使用者透過USB-C連接線將眼鏡連接至智能手機、電腦或遊戲主機等外部裝置，芯片會將輸入信號轉換為可直接顯示的格式，以投影至眼鏡內部的微型OLED面板。部分型號採用LVDS介面微型OLED面板，其他機型則採用MIPI介面微型OLED面板。芯片必須滿足嚴格的尺寸、功耗和散熱要求，以相容於AR眼鏡。

我們的芯片支持USB-C/DP1.4輸入，輸出LVDS及MIPI，可與索尼、SeeYA和其他知名面板製造商的微型OLED面板兼容。其整合USB-C PD控制器、MCU、Flash及豐富的IO，簡化系統設計。專為AR眼鏡應用而設計，該芯片具備高度整合性、廣泛兼容性，並與領先面板製造商合作提供成熟的參考設計。例如，索尼的微型OLED面板採用特殊

業 務

數據格式，而我們的產品是首批支持此格式的解決方案之一。此外，我們的芯片整合至外部運算單元，為基於採用高通SoC的主流Android XR平台打造的高階AR眼鏡系統進行視頻處理。

AI & HPC

我們正積極拓展至AI & HPC領域。我們開發中的AI & HPC解決方案組合旨在強化計算單元之間及從儲存到運算架構的連接能力。我們已開發出用於儲存擴充且支持PCIe的SATA主控芯片原型，我們亦正在開發用於信號完整性的PCIe5.0 Retimer（可與CXL2.0兼容），並正在計劃推出用於複雜數據路由的高效能交換解決方案。連同我們的視頻採集技術，這些創新旨在創造一個全面的互連生態系統，為AI時代的基礎架構提供動力。

我們用於AI & HPC的芯片有以下競爭優勢：

- **用於提升存儲可擴張性的PCIe轉SATA解決方案：**我們已成功開發用於AI PC及服務器且支持PCIe的SATA主控芯片，可大幅擴大儲存容量，滿足對靈活且高密度的儲存架構日益增長的需求。
- **用於高分辨率低延遲的HDMI2.1轉PCIe4.0芯片：**我們已成功完成HDMI2.1轉PCIe4.0芯片的流片，以支持高分辨率及低延遲。配合運算單元，該芯片可處理進階影像捕捉、渲染、處理與辨識功能，滿足人工智能視覺及資料中心視頻處理場景中的專業需求。例如，該芯片可整合至AI PC中，實現多路高分辨率影像採集及顯示處理功能。
- **開發中的下一代PCIe5.0 Retimer：**我們正開發一款PCIe5.0 Retimer（可與CXL2.0兼容），目前已取得顯著進展，預計於2026年上半年完成流片。作為高速信號傳輸的核心部件，PCIe5.0 Retimer不僅能為服務器與人工智能集群保護信號完整性，更能推動系統架構優化，能支持多CPU/GPU互連與分散式儲存子系統部署。
- **高帶寬及低延遲：**運用我們在SerDes方面的專業知識，我們已開發並量產通用單通道12.5Gbps高速信號中繼芯片。該產品用於本地5G通訊，降低基站設備的長距離信號衰減，並已獲主要通訊生產商廣泛採用。
- **高抗干擾性及可靠性：**透過採用差分信號、先進均衡（包括FFE及CTLE/DFE）及誤碼校正技術，我們的解決方案即使在複雜的工業電磁環境中仍能維持信號完整性，保證穩定可靠運作。

案例研究：與一家領先電信設備生產商就高速信號增強芯片合作

我們已與中國一家領先的電信設備生產商建立長期合作關係，以開發其5G通訊基站系統產品，其要求在背板上的不同功能板間進行高速數據傳輸。因此，客戶需要能夠在高速傳輸下解決衰減、時序偏移和抖動，並恢復信號完整性的高速信號增強芯片。

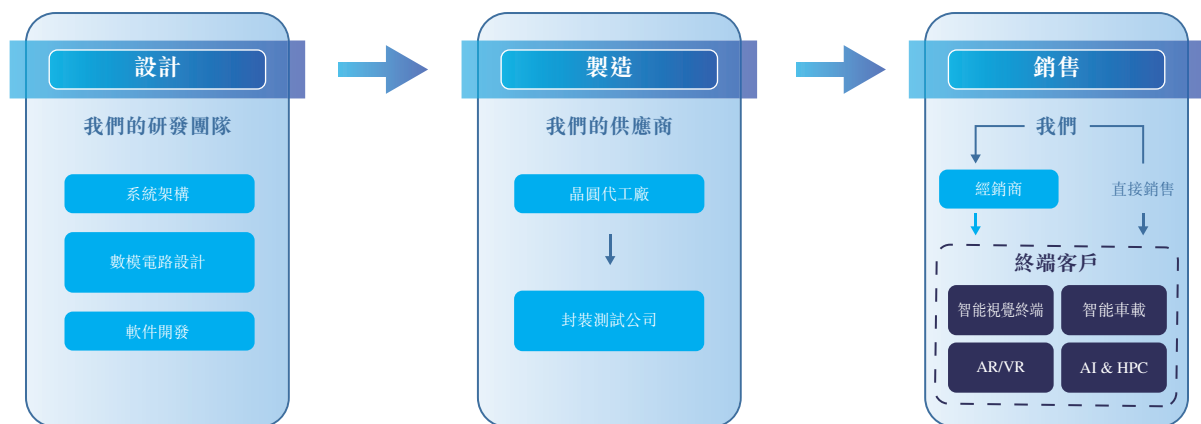
業 務

我們獨立開發了可用作先進「信號中繼站」的重驅動器／重定時器芯片。這些芯片就像中繼器一樣，可接收退化的信號，利用先進的均衡和時鐘數據恢復技術修正時序異常，然後以已恢復的完整性重新傳輸。我們的解決方案支持高達12.5Gbps的數據速率，即使在穿越基於10G-KR乙太網標準的複雜背板架構時，也能確保數據保持完整。此外，這些芯片具備整合式交換功能，可充當「交通」控制器，在CAUI-10和PCIe等各類協議的多個通道之間靈活地路由數據。部署我們的重驅動器／重定時器芯片之後，信號質量大幅提升，滿足客戶對關鍵任務基礎架構的嚴格要求。此外，我們正共同探索具備更高傳輸速率的下一代重驅動器／重定時器芯片。我們與客戶的合作延伸至雲端運算與視頻會議系統等其他產品線，其中我們的智能視頻芯片與互連芯片已開始量產。這次在5G基礎設施中的成功部署，驗證了我們解決關鍵時序與同步挑戰的能力，為我們向AI及HPC市場進行戰略性擴張奠定了技術基礎。

我們的FABLESS業務模式

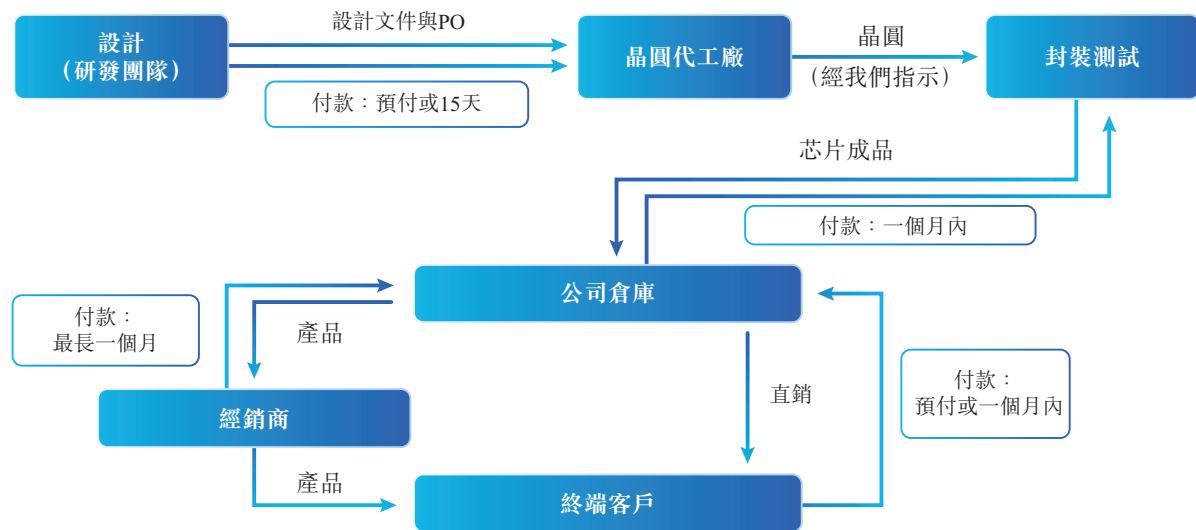
自成立以來，我們一直以fabless模式開展經營，主要專注於集成電路的研發和銷售。完成芯片設計後，我們委託晶圓代工廠進行生產並委託第三方公司進行封裝測試服務。外包產品質量檢測後，我們會直接或通過經銷商將產品出售給下游客戶。根據弗若斯特沙利文的資料，fabless業務模式符合半導體行業專業化分工日益增強的趨勢，使以fabless模式運營的公司可集中精力及資源進行研發。

下圖說明我們的fabless業務模式：



業 務

下圖說明我們與主要參與者之間的工作、交易及資金流動：



各方的角色、職責及付款方式如下：

- **晶圓代工廠**。晶圓代工廠根據我們的設計規格製造晶圓。設計缺陷風險由我們承擔；生產缺陷風險由代工廠承擔。付款方式為預付款或交付後15天內付款。
- **封裝測試公司**。封裝測試公司將晶圓封裝成芯片成品，並根據我們的指示進行測試。設計相關故障風險由我們承擔；工藝缺陷風險由服務提供商承擔。款項通常於交付後一個月內支付。
- **經銷商**。經銷商採購我們的產品，在交付時取得所有權及承擔風險，並參照我們的建議指引，以自身釐定的價格向終端客戶轉售產品。我們對因我們造成的缺陷接受保修索賠。我們為經銷商提供最長一個月的信用期。產品退貨僅限於有缺陷的產品。
- **直銷**。其次，我們直接向客戶銷售產品。我們採用此直銷模式，促進消費類應用領域的聯合產品開發與市場推廣。直銷客戶一般在交付前預先付款。在有限情況下，我們會授予小額信用額度及最長一個月的信用期。

通過與晶圓代工廠和封裝測試公司等成熟的第三方合作夥伴合作，我們能夠獲得先進製造技術及規模經濟效益。這種合作夥伴關係提高我們產品的性能及可靠性，同時使我們能夠保持精益、靈活的運營模式，並有效地分配資源。

我們的核心技術

我們秉持核心技術全棧自研的戰略理念。ClearEdge包含來自100多個芯片開發項目的設計庫、開發工具和電路設計數據，融合我們的三大核心技術：(i)高帶寬SerDes、(ii)高速協議處理及數據加密及(iii)高清視頻處理及顯示驅動，奠定我們在芯片設計、協議棧開發及上層應用優化方面的全面競爭優勢。

業 務

ClearEdge具備兩大功能：第一，使我們能以最小修改，將模擬電路設計移植至不同晶圓代工廠，從而提升供應鏈靈活性；第二，允許我們在不同產品線之間重複使用經過驗證的電路設計，從而加快新產品上市速度。例如，我們通過對DP1.4視頻橋接芯片更新換代，逐步優化SerDes接收器設計。由於PCIe3.0與DP1.4對信號完整性的要求相近，我們僅需進行接口層面的修改，便已將此成熟的SerDes架構應用於我們支持PCIe的SATA主控芯片。

我們的全棧自研核心技術

高帶寬SerDes技術

SerDes技術對現代高速連接至關重要。其可將並行資料轉換成高速串列信號傳輸，並在接收器上解壓回並行資料，讓大量資料透過較少的纜線傳輸，同時將串擾和時序偏移至最低。因此，其可實現芯片、模組和系統之間的高帶寬、低延遲和高可靠性通信。

在傳輸端，我們採用多級預加重架構和噪聲抑制技術，顯著提升信號完整性與抗干擾性能。在接收端，我們集成自適應信號均衡控制、時鐘數據恢復(「CDR」)及高精度時鐘相位插值器，系統性攻克有線通信中因傳輸距離和介質導致的信號衰減、時序偏移等瓶頸。

收發系統亦採用高性能鎖相環(PLL)電路設計，具有自動溫度檢測與實時補償機制，有效降低環境波動影響。通過內置高精度基準電壓源串並轉換(SerDes)電路結構，我們的SerDes技術已穩定支持最高20Gbps數據傳輸速率，並結合FEC機制，可在長距離傳輸中實現 10^{-12} 以下的BER。研發正向最高32Gbps的數據傳輸速率推進。

我們的SerDes技術兼容多種主流視頻協議與通信標準。通過系統級功耗管理與信號路徑優化，我們的解決方案兼具高帶寬、高可靠性、低功耗和低延遲特性，適用於下一代通信基礎設施、超高清視頻傳輸、工業物聯網及AI應用。

高速傳輸協議處理及數據加密技術

我們對視頻信號協議的廣泛覆蓋實現了行業領先的版本兼容性。具體而言，我們的產品全面支持HDMI、DP/eDP、USB、MIPI、LVDS、VGA等當前行業主流高清視頻接口協議：

- **HDMI**：我們是最早專注於研發HDMI產品的行業參與者之一，產品矩陣支持HDMI2.1版本，傳輸帶寬高達12Gbps，即超高清視頻流暢傳輸的現行黃金標準；同時支持VRR可變刷新率技術，減少畫面撕裂與卡頓；支持eARC高質量聲音回傳功能；兼容DSC視頻壓縮格式，在保證畫質前提下降低傳輸帶寬；支持HDCP2.3加密技術保護視頻內容安全；及支持動態HDR技術呈現豐富色彩與高對比度視覺效果。我們的HDMI解決方案覆蓋家庭影院、專業顯示設備及工業控制等場景需求，並已經過嚴格兼容性測試與量產驗證，獲客戶持續認可。

業 務

- **DP：**我們的DP2.1解決方案支持高達80Gbps帶寬，這是全球顯示器界面標準的權威機構視頻電子標準協會(VESA)目前針對大眾市場顯示器所定義的最高帶寬規格之一。這些解決方案可驅動單路無壓縮8K@60Hz HDR或4K@240Hz HDR顯示器，配合DSC可驅動單路8K@120Hz HDR或雙路4K@144Hz HDR顯示，並支持10K@60Hz顯示能力，使我們的技術處於下一代超高清顯示的最前端。同時支持Adaptive-Sync，確保畫面流暢無卡頓；支持多流傳輸，通過單一鏈路傳輸多個顯示流；支持低功耗狀態以延長電池續航。
- **USB：**我們也提供USB信號延長芯片和USB3.2協議轉換芯片，支持UVC進行多路視頻傳輸。作為USB-C協議芯片的早期開發商，我們的產品支持USB-C PD (充電最大電壓達48V) 和USB-C DP Alt Mode，實現適用於高效能筆記本電腦的快速高功率充電，其充電效率超出普通移動設備標準。
- **MIPI：**我們自主研發的MIPI產品，支持最多MIPI 3.0 D-PHY/C-PHY，採用combo設計方式優化芯片面積與功耗。物理層支持標準D-PHY/C-PHY，協議層支持標準DSI/CSI-2。接收端D-PHY每通道最高支持4.5Gbps, C-PHY每通道最高支持3.5Gbps；發射端分別最高支持6Gbps及6Gbps。DSI支持Video/Command模式及低速雙向通信；CSI-2支持多路虛擬通道數據接收與透傳發送，單路視頻分辨率最高達8K@60Hz，滿足頂級VR和汽車駕駛艙系統對延遲和分辨率的嚴格要求。

我們的產品亦支持音頻數據接收、發送、eARC、時鐘恢復、解析及聲畫同步。此外，我們已就智能車載內的音響系統研發MAL (Multi-Audio Link)協議，採用半雙工通道共享傳輸方式，雙向速率達98.304Mbps，級聯數量最大達8級。MAL可自動檢測上下游鏈路連接狀態與級聯數量，電源接收範圍5V-12V，支持線上供電，支持TDM、I2S、PDM等接口。

此外，為確保數據傳輸過程中的安全性，我們芯片的發射端與接收端均內建了數據加密與解密技術模塊。通過設備認證、信號加密及驗證機制，僅允許授權設備解密並使用受保護內容，防止未經授權的複製、截取和使用。這為4K/8K超高清視頻傳輸及通用數據傳輸等場景提供了端到端的安全傳輸解決方案。

高清視頻處理和顯示驅動技術

經過多年的研發，我們已開發專有視頻處理和顯示驅動技術組合，旨在優化三個關鍵層面的視覺效能：

- **視覺保真度：**Local Dimming (局部調光)、HDR (高動態範圍)、Gamma (伽馬校正)、Uniformity (均勻性)、Color Management (色彩管理)、Sharpness (圖像銳化) 和3D-LUT (三維查找表) 等技術可提供影院級的色彩準確度和卓越的對比度；
- **動態流暢：**Over-Drive (過驅動)、FRC (幀率控制) 和De-interlace (去隔行) 在內的功能可消除快節奏內容中的動態模糊和重影；及
- **顯示靈活：**Scaler (圖像縮放)、Rotation (旋轉)、Warping (畸形校正) 及Cropping (裁剪) 等功能可讓內容適應曲面屏幕 (常見於汽車駕駛艙)、視頻牆及非標準長寬比顯示設備。

此外，我們的處理套件還包括OSD (屏幕顯示)、DSC、PIP/PBP (畫中畫／畫旁畫，用於多來源檢視)、3D畫格分割、MST以及基於RISC-V的處理功能。

業 務

憑藉我們自主研發的LPDDR4、DDR3及PSRAM存儲控制器技術，我們提供一條完整的處理管道，覆蓋從視頻輸入到顯示輸出的全流程，能實現對4K/8K超高清格式的高效、穩定和低延遲處理。我們的技術同時具有低功耗特性，並能適應多樣化的應用場景。我們將繼續深化研發，拓展視頻SoC、視頻橋接及端側AI計算等領域，提供更靈活、高效的視頻處理解決方案。

研究及開發

我們的研發團隊

我們專業及經驗豐富的研發團隊在創始人FENG CHEN（陳峰）先生的策略指導下運作，其多年的行業經驗為我們塑造整體的研發方向與技術路線圖。有關陳先生的資料及背景詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

我們組建了專門的研發團隊，專注於芯片設計。截至2025年12月31日，我們的研發團隊包括192名員工，其中56.8%持有碩士或以上學位。於2023年、2024年及2025，我們的研發開支分別為人民幣74.5百萬元、人民幣100.0百萬元及人民幣113.2百萬元，佔各期間總收入的23.1%、21.5%及19.9%。

研發流程

我們的新產品研發流程包括四個階段：

- **項目立項**。我們將客戶需求與自身技術能力進行對接，隨後提交項目計劃以進行可行性審核。
- **項目規劃**。我們將明確設計目標，準備初步系統架構和驗證方案，並開展審核。經確定獲批設計方案後，產品開發會正式啟動。
- **設計與驗證**。我們的研發團隊開展詳細的芯片設計與仿真工作，涵蓋系統架構、數字與模擬電路設計、UVM及FPGA驗證、佈局及封裝設計以及軟件開發。在進入掩模生產前，我們將進行流片前審核，以確保所有設計參數符合技術規範。
- **產品驗證及量產**。我們對來自小規模試生產的芯片樣品進行測試，隨後我們將完成量產測試、應用解決方案開發與測試以及可靠性測試。通過有關測試後，產品符合規格進行量產。

關鍵在研項目

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們一直從事與我們的核心產品相關技術的多個研發項目。所有在研項目均由我們獨立進行，並對研發過程保持完全控制。下表說明我們的關鍵在研項目：

項目名稱	目前階段	應用領域
多功能顯示控制器.....	設計與驗證	超高清顯示器、視頻牆及智能終端系統。

業 務

項目名稱	目前階段	應用領域
視頻橋接	產品驗證	AR/VR、AI & HPC、智能車載及智能終端系統。
PCIe5.0/CXL2.0 Retimer	設計與驗證	AI & HPC。
20.25G SerDes.....	設計與驗證	智能車載、AR/VR及智能終端系統。
端側空間計算SoC.....	設計與驗證	AR/VR及機器人。

研發中心

截至最後實際可行日期，我們在中國運營兩個研發中心。位於合肥的總部是我們的主要研發基地，專注於智能視頻芯片及互連芯片的開發、應用解決方案的設計以及整體運營。我們的深圳中心側重於芯片應用解決方案的開發，以及營銷及銷售。

供應鏈管理

採購

我們以fabless模式運營，以優化我們的研發、設計及銷售能力。我們將芯片生產環節委託給晶圓代工廠和封裝測試公司。於往績記錄期，我們主要向晶圓代工廠採購晶圓製造服務，並自封裝測試公司採購封裝測試服務。我們非常重視向具有良好聲譽和往績記錄的供應商採購原材料和服務。

採購流程。市場銷售部根據客戶需求提供滾動的銷售計劃，物流採購部根據銷售計劃、訂單需求及產品庫存水平擬定採購和生產計劃，安排晶圓製造訂單和封裝測試訂單。晶圓代工廠完成晶圓製造並通過質量檢驗後，我們會指示代工廠將晶圓發至指定封裝測試廠。晶圓到達封裝測試廠後，我們會下達封裝測試訂單，封裝測試廠則按訂單要求進行封裝測試流程。芯片生產完成後將暫存在封裝測試廠或者按我們的指示發至指定地點。

委外生產質量控制。我們透過以下措施管理和監控委外芯片生產：優化生產參數並監控良率數據以持續提升產品良率；要求代工廠遵循標準控制計劃實施全面質量管理；對每顆芯片進行標識以實現溯源，追溯至晶圓製造、封裝測試環節的信息。

付款流程和信用政策。我們與晶圓代工廠通常有生產前預付和生產完成後結算兩種付款方式。生產前預付方式按照所簽訂的採購訂單完成預付；生產完成後結算方式則按照產品入庫和供應商進行對賬，核對無誤後按照約定付款期限完成付款。我們與封裝測試廠商通常按照合同約定期限方式進行結算。全部付款均採用銀行轉賬方式，不存在現金付款情況。

業 務

晶圓製造及芯片封裝測試服務的潛在定價波動可能由於全球及國內產能、不斷演變的政府法規、供需動態變化及地緣政治狀況(包括貿易限制、關稅和國際衝突)等因素而產生。為減低該等風險，我們已利用國內及國際製造資源建立雙軌供應體系。請參閱「— 優勢 — 高效靈活的雙軌供應體系」。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們的採購並未出現對我們的運營造成重大影響的質量問題或短缺。

我們的供應商

供應商篩選及管理

於往績記錄期，我們的供應商主要包括(i)晶圓代工廠；及(ii)提供封裝測試服務的公司。我們通常委聘信譽良好的供應商以確保我們的產品質量。我們在選擇供應商時考慮一系列綜合因素，主要包括技術專長、服務質量、生產能力、響應及商業表現。評估通過的供應商將納入由我們的供應鏈與質量部門所存備的《合格供方名錄》內。我們就合資格供應商的價格、質量、交付與服務對其定期進行績效審核。不合規或重大質量問題將觸發即時重新評估，可能導致從《合格供方名錄》中移除。

我們一般基於需求預測向供應商發出採購訂單。我們的需求預測延伸至六個月，並根據歷史市場需求模式及我們管理團隊的行業及市場經驗和見解，每月滾動更新。我們的供應商收到採購訂單後確認並簽署採購訂單。對於境內代工廠及芯片封裝測試公司而言，我們通常訂立框架協議，其載列採購的一般條款及條件。

我們與供應商簽訂的供應協議的主要條款通常包括：

- **期限**。我們與主要供應商簽訂的採購協議通常並無固定期限。
- **定價**。價格由我們與供應商在報價單或特定採購訂單中共同決定。
- **付款及信用期**。付款條款通常在報價單或特定採購訂單中列明，而非框架協議。我們通常會獲得一個月內的信用期。
- **最低採購要求**。我們與主要供應商簽訂的採購協議一般並無載有最低採購要求。
- **質量與產品退貨**。我們通常會與供應商協定良率。如良率低於協定水平，我們可以要求退貨，或由供應商承擔良率差異的成本損失。
- **物流**。我們的供應商通常安排向我們交付原材料或元件的物流。
- **終止／續約**。協議一般可由任何一方於發生一系列事件(包括另一方並無糾正不履行協議項下的義務)時終止。

業 務

我們的主要供應商

於往績記錄期，我們於各年度的五大供應商採購的金額分別為人民幣153.8百萬元、人民幣235.9百萬元及人民幣282.3百萬元，分別佔我們採購總額的83.2%、93.1%及90.6%。此外，我們自往績記錄期內各年度的最大供應商採購的金額分別為人民幣63.3百萬元、人民幣104.1百萬元及人民幣121.4百萬元，分別佔我們採購總額的34.3%、41.1%及39.0%。有關我們依賴少數供應商的詳情，請參閱「風險因素 — 有關我們業務及行業的風險 — 我們與第三方晶圓代工廠及封裝測試服務供應商合作。由於我們依賴這些主要供應商，因此我們面臨供應商集中風險」。

據我們所深知，於往績記錄期及截至最後實際可行日期，往績記錄期各年度我們的五大供應商均為獨立第三方。供應商E為我們於2023年及2024年的五大供應商之一。我們其中一名股東持有供應商E不足30%的股權。該股東(與另一名股東一致行動)於2024年7月12日前持有我們的已發行股本5%以上，其後，他們減持本公司股份至低於5%。

於最後實際可行日期，董事、其緊密聯繫人或任何股東(據董事所知擁有我們的已發行股本5%以上者)於往績記錄期各年度概無於五大供應商中擁有任何權益。此外，我們於往績記錄期及直至最後實際可行日期並無與供應商發生任何重大糾紛。

下表載列於往績記錄期內各年度我們五大供應商的詳情。我們透過銀行轉賬結算與五大供應商的交易。

排名	供應商	所提供產品/ 服務類型	採購金額 人民幣千元	佔採購總額的 百分比 %	信用期	開始建立業務關係的年份
截至2023年12月31日止年度						
1	供應商A ⁽¹⁾	晶圓製造	63,278	34.3	15天	2012年
2	供應商B ⁽²⁾	晶圓製造	50,476	27.3	預先付款	2018年
3	供應商C ⁽³⁾	封裝測試	22,065	11.9	1個月	2011年
4	供應商D ⁽⁴⁾	封裝測試	10,062	5.4	1個月	2020年
5	供應商E ⁽⁵⁾	測試	7,895	4.3	1個月	2021年
總計			153,776	83.2		
截至2024年12月31日止年度						
1	供應商A ⁽¹⁾	晶圓製造	104,122	41.1	15天	2012年
2	供應商B ⁽²⁾	晶圓製造	78,569	31.0	1個月	2018年
3	供應商C ⁽³⁾	封裝測試	30,954	12.2	1個月	2011年
4	供應商D ⁽⁴⁾	封裝測試	13,516	5.3	1個月	2020年
5	供應商E ⁽⁵⁾	測試	8,719	3.4	1個月	2021年
總計			235,880	93.1		
截至2025年12月31日止年度						
1	供應商A ⁽¹⁾	晶圓製造	121,397	39.0	15天	2012年
2	供應商B ⁽²⁾	晶圓製造	90,201	28.9	1個月	2018年
3	供應商C ⁽³⁾	封裝測試	43,157	13.9	1個月	2011年
4	供應商D ⁽⁴⁾	封裝測試	14,485	4.7	1個月	2020年
5	供應商F ⁽⁶⁾	封裝測試	13,106	4.2	1個月	2021年
總計			282,346	90.6		

業 務

附註：

- (1) 供應商A總部位於馬來西亞，從事晶圓代工生產業務。
- (2) 供應商B總部位於中國台灣，從事晶圓代工生產業務。
- (3) 供應商C總部位於中國台灣，從事封裝測試代工服務業務。
- (4) 供應商D總部位於中國江蘇省，從事封裝測試代工服務業務。
- (5) 供應商E總部位於中國安徽省，從事晶圓及芯片測試代工服務。
- (6) 供應商F總部位於中國安徽省，從事封裝測試代工服務業務及中階測試平台。

在往績記錄期，我們分別於2023年聘請了兩家晶圓代工廠及五家封裝測試服務供應商，於2024年聘請了三家晶圓代工廠及六家封裝測試服務供應商，於2025年聘請了四家晶圓代工廠及六家封裝測試服務供應商。

我們主要依靠兩家晶圓代工廠進行芯片製造。於往績記錄期，我們主要向供應商A及供應商B採購晶圓及光罩。於2023年、2024年及2025年，我們來自供應商A及供應商B的合計採購額分別佔我們採購總額的61.6%、72.1%及67.9%。供應商A為一家總部位於馬來西亞的半導體製造商。供應商B為一家位於中國台灣的半導體製造商。我們於2012年開始與供應商A進行業務合作，並於2018年開始與供應商B進行業務合作。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的晶圓製造收入計，就收入而言，供應商A排名東南亞市場前十名，而供應商B則排名全球前五名。

儘管我們並無與供應商A或供應商B簽訂長期協議，但考慮到長期的合作關係，該等供應關係保持穩固且穩定。此外，根據弗若斯特沙利文的資料，芯片設計公司依賴少數晶圓廠夥伴採購大部分晶圓符合行業慣例。由於我們從供應商A及供應商B採購大部分晶圓，若我們與任一供應商的關係以任何不利於我們的方式終止、中斷或變更，我們的營運及業務可能會受到嚴重中斷。請參閱「風險因素 — 有關我們業務及行業的風險 — 我們與第三方晶圓代工廠及封裝測試服務供應商合作。由於我們依賴這些主要供應商，因此我們面臨供應商集中風險」。

我們已擴展採購網絡，納入其他合資格晶圓製造商(包括位於中國的製造商)，以確保晶圓供應的穩定性及靈活性。於往績記錄期，我們已與另外兩家晶圓製造商建立穩定合作關係，且推進若干產品進入流片階段。該等製造商已證明其有能力在合理的商業條款下，符合行業標準及我們的營運需求、製造能力及產品質量要求。我們向該等製造商採購的商業條款與供應商A及供應商B的條款相若。根據弗若斯特沙利文的資料，我們向該等製造商採購的商業條款符合行業慣例。我們知悉存在其他具備技術知識的替代製造商，能夠在合理的商業條款下生產與供應商A及供應商B目前所供應產品功能相似、但價格、質量及規格存在一定差異的產品。我們的董事認為，我們與供應商A及供應商B的關係不太可能發生重大不利變動或終止，原因在於(i)我們與供應商A及供應商B已維持約十年的長期穩定關係，及(ii)於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們與供應商A或供應商B並無任何糾紛。

在封裝測試服務方面，我們聘用了多家服務供應商。根據弗若斯特沙利文的資料，我們向該等服務供應商採購的商業條款符合業界標準。我們已存置一份能夠為我們提供相若質量及商業條款的合資格替代供應商名單。

業 務

於往績記錄期及截至最後實際可行日期，我們與主要供應商維持穩定關係，而董事認為我們與主要供應商之業務關係並無終止之風險。此外，董事並不知悉任何潛在終止之跡象。

銷售、營銷及經銷

我們的銷售網絡

我們的產品為標準化產品，下游應用領域廣泛。我們的客戶群體相對分散，且我們大部分終端客戶採購芯片種類較多，更傾向於通過經銷商進行集中採購。因此，我們的銷售模式以經銷為主，直銷為輔。我們與經銷商保持買賣關係：其向我們採購產品，所有權和風險在交付時轉移，並參照我們的建議指引，以自行釐定的價格將產品轉售予終端客戶。於往績記錄期，我們的絕大部分收入來自經銷商，彼等向不同行業的終端客戶出售我們的芯片。

下表載列於所示期間按銷售渠道劃分的收入貢獻明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)					
經銷.....	319,481	98.9	459,835	98.7	561,284	98.8
直銷.....	3,666	1.1	6,168	1.3	6,920	1.2
總計.....	323,147	100.0	466,003	100.0	568,204	100.0

在直銷模式下，我們直接向終端客戶銷售產品，該等客戶主要為總部位於中國的消費電子公司及影音設備供應商。該等終端客戶通常在其所屬領域中已具相當規模，並採購我們的產品以整合至其自有產品。我們一直積極拓展海外銷售網絡。憑藉自身營銷推廣優勢及經銷商渠道，我們在海外市場的覆蓋範圍及客戶群體顯著擴大，例如韓國、日本及東南亞等地區。於2023年12月，我們於新加坡設立子公司，以進一步強化海外銷售策略。

我們的經銷渠道

概覽

於往績記錄期，我們主要通過第三方專業經銷商推廣及銷售我們的產品。經銷模式減少了我們在銷售環節的資源投入，有利我們專注於產品研發及供應鏈管理環節。經銷商的主要作用包括：(i)協助我們開拓新下游終端客戶、維護客戶關係，並提供售後服務；(ii)支持日常終端客戶管理，以提升業務運作效率和市場響應速度；及(iii)促進更快的回款，以改善現金流並降低應收賬款的回收風險。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國，fabless芯片設計公司委任經銷商進行產品銷售是一種行業慣例。

業 務

我們的產品由我們的經銷商最終銷售予終端客戶，該等終端客戶主要包括(i)智能視覺終端應用領域的消費電子製造商及商顯解決方案提供商；(ii)智能車載應用領域的汽車OEM與一級供應商；(iii)AR/VR應用領域的AR/VR設備製造商；及(iv)AI & HPC應用領域的服務器及計算設備製造商。由於我們為維持與經銷商的買賣關係，而未與終端客戶建立直接合同關係，我們無法完全了解所有終端客戶的身份信息，亦無法準確了解終端市場的收入明細。

據我們所深知，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無任何二級經銷商。經銷商產生的歷史銷售一般屬經常性，惟下文詳述我們與若干經銷商終止業務關係的情況除外。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無發現經銷商發生任何重大不合規事件。

在往績記錄期，我們一般每年或每半年向我們的主要經銷商（「**認證經銷商**」）出具授權證書，及與彼等訂立經銷協議。截至2025年12月31日，我們共有25名認證經銷商，主要是半導體行業的專業經銷商，提供全面的現代供應鏈服務。作為經銷網絡的補充，我們亦與身為獨立第三方的其他經銷商進行交易。該等其他經銷商一般包括(i)擁有穩固客戶群的新經銷商，但在取得認證狀態前，正接受我們對其業務發展能力、技術支援能力及市場回饋的評估；及(ii)進行臨時或不定期採購的經銷商。我們並無與該等其他經銷商簽訂經銷協議，彼等通常以臨時基礎(ad-hoc basis)向我們下達採購訂單。我們對該等其他經銷商的銷售管理等同於直銷，各方僅遵守採購訂單中的條款。

下表載列我們於所示期間的認證經銷商數目變動。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
期初.....	28	30	32
新增認證經銷商.....	4	3	3
終止認證經銷商.....	2	1	10
期末認證經銷商.....	<u>30</u>	<u>32</u>	<u>25</u>

於2023年、2024年及2025年，我們分別委任四名、三名及三名新認證經銷商。於2024年，我們認證了另外一名經銷商為我們的認證經銷商，其符合我們的認證要求。

業 務

下表載列我們於所示期間的其他經銷商數目變動。

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
期初.....	11	9	9
新增其他經銷商.....	2	3	—
終止其他經銷商.....	4	2	6
認證其他經銷商為認證經銷商.....	—	1	—
期末其他經銷商.....	9	9	3

於2023年、2024年及2025年，我們分別與兩名、一名及十名認證經銷商終止合作關係，主要由於他們未能持續符合我們對業務記錄、市場影響力及技術支持能力的要求。此外，我們在2023年、2024年和2025年分別終止了四家、兩家和六家其他經銷商，主要原因是(i)若干其他經銷商後來在我們的評估程序後不符合成為認證經銷商的資格，或(ii)臨時或特定的採購需求已滿足，不再進行採購。於2025年，終止合作關係的數量增加反映我們整合經銷網絡的戰略舉措，這與弗若斯特沙利文觀察到的行業趨勢相符。此項優化使我們能將資源集中在業績卓越的認證經銷商，從而提高服務效率並激勵經銷商。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無與該等解除關係的認證經銷商發生任何重大未決糾紛或訴訟。

據我們所深知，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們的所有經銷商均為獨立第三方。據我們所深知，除與我們訂立的日常經銷安排外，經銷商與本公司、我們的子公司、擁有已發行股份總數5%或以上的股東、董事或高級管理層或他們各自的任何聯繫人概無其他關係。

與經銷商的主要合同條款

我們與認證經銷商的經銷協議的主要條款包括以下各項：

- **期限**。經銷授權的期限通常為一年。
- **採購**。採購金額在採購訂單中訂明。
- **售價和付款**。我們通常根據市場競爭狀況、原材料價格、內部政策和監管環境設定售價指引。我們會按具體情況，向認證經銷商提供自完成履約義務後至多一個月的信用期以及信用額度。
- **產品退換**。我們通常不允許認證經銷商退貨或換貨，但認證經銷商可與我們協商因我們的過失而導致瑕疵產品的退貨和賠償事宜。
- **產品保修**。我們為芯片產品提供兩年保修期。保修範圍涵蓋因製造缺陷或設計缺陷導致產品規格不合規的情況，但因不當應用或正常磨損造成的缺陷除外。保修責任由我們直接承擔。

我們與其他經銷商的採購訂單的主要條款包括以下各項：

- **產品採購**。其他經銷商的採購訂單通常會註明產品名稱、型號、規格、數量、價格、送貨地點及送貨時間。

業 務

- **售價。**價格一般由雙方協定，並在相關的採購訂單中列明。
- **付款及信用條款。**其他經銷商一般在交貨前預先付款。

健全的認證經銷商管理

有效的經銷網絡對於提升我們的銷售業績和確保終端客戶滿意度至關重要。因此，我們在以下各方面對認證經銷商維持嚴格的管理。

- **篩選程序。**我們選擇的認證經銷商須為合法註冊的經營實體，具備良好商業記錄、強大市場影響力及相關行業的技術支持能力，並能夠實現快速的銷售增長。
- **績效審核。**我們對認證經銷商進行季度及年度審核，綜合評估其關鍵指標的表現，包括市場開發能力、技術支持熟練程度、財務實力、營運合規性及採購量。
- **存貨管理。**我們的認證經銷商須在每月月底前提提交六個月滾動預測，該預測將作為生產計劃與庫存準備的基礎。認證經銷商通常根據提交的預測下單，未提前提交預測的訂單將視庫存可用性或生產能力而定。
- **渠道囤積與同行蠶食風險管理。**我們已採取以下措施來管理經銷相關的風險：

- (i) **渠道囤積。**我們根據認證經銷商下達的採購訂單，以買賣關係向其銷售產品。我們於銷售後不對認證經銷商的存貨水平進行監控或管理。鑑於此，儘管我們設有績效目標，我們不對認證經銷商施加最低採購量要求，且認證經銷商一般不得將任何未售出的產品退還予我們，我們的董事認為我們並無任何重大渠道囤積問題。

我們認為，我們的銷售反映了終端客戶的實際需求，盡量降低渠道囤積和存貨積壓的風險，是由於(i)除有限原因(如產品缺陷)外，我們通常不允許經銷商退回已售產品；(ii)AI技術的進步及AI系統性能要求的提升，推動產品快速迭代升級；及(iii)我們對經銷商授出短期信用期或要求預先付款，且不設最低採購量要求，鼓勵經銷商根據其各自的存貨水平和市場需求自主採購。我們認為，有關安排有助於經銷商依據實際銷售預測下單。

- (ii) **同行蠶食。**我們也採取有效措施以盡量降低同行蠶食風險，包括：(a)**管理機制**：我們要求同一區域內的認證經銷商在篩選過程中應具備互補優勢，在我們的產品方面，盡量減少客戶關係重疊；(b)**調查機制**：我們也會調查所發現的同行蠶食事件，即兩名或以上認證經銷商爭奪同一客戶的情況，並保留終止與做出同行蠶食行為的認證經銷商的業務關係的權利；及(c)**建**

業 務

議市場價格：我們通常根據市場競爭狀況、原材料價格、內部政策及監管環境制定售價指導方針。

- **賦能。**我們定期舉辦培訓課程，與認證經銷商分享專業技術、產品信息和行業知識，並與他們攜手合作，以增強銷售技巧、優化銷售策略，並使我們的營銷資源發揮最大效用。

於往績記錄期，由於其他經銷商並非我們認證經銷網絡的一部分，因此我們並無將適用於認證經銷商的管理政策應用於其他經銷商，而其他經銷商僅包括正在接受我們評估程序的新經銷商或進行臨時或特定採購的經銷商。鑑於這些關係的範圍有限、屬臨時性質且對收入的貢獻微不足道，我們對該等其他經銷商的銷售管理方式與我們的直銷安排大致相同，而非將其納入適用於認證經銷商的管理要求。與我們的一般政策一致，(1)除因我方過錯導致的缺陷產品外，我們通常不允許其退貨；及(2)我們不對其施加最低採購額要求。於2025年，來自該等其他經銷商的收益並不重大，佔我們經銷商總收益的不足3%。

直銷

在少數情況下，我們直接向客戶(主要包括於我們早期發展階段建立長期關係的合作夥伴，以及需要深入客製化的製造商)銷售我們的產品。我們採納此直銷模式，為消費者應用促進共同產品開發及市場推廣。我們繼續維持這些關係，以支持特定項目要求，並確保業務得以持續。

於2023年、2024年及2025年，來自我們直銷客戶的收入分別為人民幣3.7百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣6.9百萬元，佔我們於相應年度總收入約1.1%、1.3%及1.2%。

與直銷客戶的主要合同條款

我們與直銷客戶簽訂的框架協議的主要條款包括以下各項：

- **期限。**通常為期一至兩年，經雙方同意後可續期。
- **定價。**於具體採購訂單中確定。
- **付款及信用期。**客戶一般在交付前預先付款。在有限情況下，我們可能會授予小額信用額度及最長一個月的信用期。
- **交付及風險轉移。**我們將產品交付至客戶指定的地點。損失風險自驗收後轉移至客戶。
- **質量及產品退貨。**客戶可在交付後驗貨。我們必須在規定時間內(例如三天)取回和更換不合格品。
- **終止。**可在雙方協議或重大違約時終止。我們必須提前書面通知(例如一至三個月)，並在停止供應前取得客戶同意。

業 務

客戶服務及技術支持

我們致力於提供優質的客戶服務。我們投身於處理及解決客戶系統難題，並就優化設計提供專業指導，以滿足特定需求，確保其應用穩定運行。

定價

我們根據以下主要因素為產品定價：(i)成本覆蓋，包括研發成本、晶圓生產成本、封裝測試成本和目標利潤率；(ii)產品性能和規格，規格越高的產品通常價格越高；(iii)市場競爭狀況；及(iv)客戶特定因素，如訂單量和付款方式。我們的原材料(即晶圓)的購買價格是我們在制定定價策略時考慮的最重要因素之一。我們亦可根據特定客戶情況逐項調整最終定價。

我們對標準化和訂製化晶片產品採用不同的定價方法。對於標準化的晶片，我們在商業化推出之前，會透過成本分析、競爭基準比較及跨部門審查等結構化程序來設定基本價格。對於訂製化晶片，定價則依據項目而定，並考慮到開發工作的範圍、預期產量及項目特定成本。我們已設立定價委員會，由總經理擔任主席，負責審核並批准新產品的基準價格及因應上游成本變動、競爭動態、技術迭代或下游需求的轉變，而作出重大價格調整。

下表載列我們於往績記錄期主要產品類別的價格範圍：

產品類別	等級	價格範圍(美元)*	行業平均價格範圍 (美元)*
視頻橋接芯片	≤4K30	1.0–2.1	0.7–2.5
	4K60	1.7–4.5	1.2–5.5
	>4K60	3.3–7.0	2.5–9.0
視頻處理芯片	≤4K30	2.3–2.5	1.2–3.0
	4K60	2.9–3.9	1.8–5.0
	>4K60	7.0–10.5	4.5–14.0
高速互連	3Gbps	0.2–1.8	0.1–2.5
	6Gbps	1.2–3.5	0.8–5.0
	8Gbps	2.4–8.7	1.5–10.0
AI運力芯片	12.5Gbps	3.0–5.0	2.0–7.0

* 根據往績記錄期的銷售額，按匯率(1美元=人民幣7元)估計。

根據弗若斯特沙利文的資料，基於上表所示的行業平均價格範圍，智能視頻芯片及互連芯片的單價處於行業價格的中位範圍。請見「行業概覽」。

業 務

市場銷售

我們的市場銷售工作專注於客戶參與度、產品推廣及品牌建立。截至2025年12月31日，我們的市場銷售部由16名成員組成，並與我們的經銷商密切合作以執行我們的營銷策略。我們的市場銷售舉措以團隊每日的客戶接觸為主，以各種推廣活動為輔，例如上門拜訪客戶、參加貿易展會、網上產品演示以及其他線上及線下活動。

我們的客戶

我們的客戶主要為經銷商。於往績記錄期，我們於各年度的五大客戶合共貢獻人民幣159.5百萬元、人民幣240.4百萬元及人民幣296.9百萬元的收入，分別佔總收入的49.4%、51.6%及52.3%。來自往績記錄期各年度最大客戶的收入分別為人民幣53.0百萬元、人民幣64.9百萬元及人民幣97.5百萬元，分別佔總收入的16.4%、13.9%及17.2%。我們於往績記錄期各年度的所有五大客戶均為獨立第三方。

據我們所深知及於最後實際可行日期，我們並不知悉將會導致我們與任何現有主要客戶終止關係的任何資料或安排。於往績記錄期各年度及直至最後實際可行日期，概無董事及他們各自的聯繫人或擁有已發行股份總數5%或以上的股東於我們任何五大客戶中擁有任何權益。

下表載列我們於往績記錄期各年度的五大客戶詳情。我們通常要求客戶預先付款，或授予客戶信用期，一般為自完成履約義務後至多一個月。我們透過銀行轉賬結算與五大客戶的交易。

排名	客戶	購買的產品／服務類型	銷售額	佔總收入的百分比	信用期	開始建立業務關係的年份
			人民幣千元	%		
截至2023年12月31日止年度						
1	客戶A ⁽¹⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	53,033	16.4	15至25天	2016年
2	客戶B ⁽²⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	30,159	9.3	15至25天	2017年
3	客戶C ⁽³⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	28,241	8.7	15至25天	2017年
4	客戶D ⁽⁴⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	27,067	8.4	15至25天	2015年
5	客戶E ⁽⁵⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	20,995	6.5	15至25天	2016年
總計			159,495	49.4		
截至2024年12月31日止年度						
1	客戶A ⁽¹⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	64,897	13.9	15至25天	2016年
2	客戶F ⁽⁶⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	51,757	11.1	15至25天	2017年
3	客戶G ⁽⁷⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	46,428	10.0	預先付款	2021年
4	客戶B ⁽²⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	39,874	8.6	15至25天	2017年
5	客戶D ⁽⁴⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	37,446	8.0	15至25天	2015年
總計			240,402	51.6		

業 務

排名	客戶	購買的產品／服務類型	銷售額	佔總收入的百分比	信用期	開始建立業務關係的年份
			人民幣千元	%		
截至2025年12月31日止年度						
1	客戶H ⁽⁸⁾	智能視頻芯片	97,453	17.2	預先付款	2024年
2	客戶A ⁽¹⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	63,703	11.2	15至25天	2016年
3	客戶F ⁽⁶⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	58,311	10.3	15至25天	2017年
4	客戶D ⁽⁴⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	50,026	8.8	15至25天	2015年
5	客戶C ⁽³⁾	智能視頻芯片、互連芯片及其他	27,417	4.8	15至25天	2017年
總計			296,910	52.3		

附註：

- (1) 客戶A總部位於中國內地，從事電子元件經銷，並提供設計鏈服務、供應鏈協同與支持服務及工業數據服務。
- (2) 客戶B總部位於中國內地，從事電子元件代理與經銷。
- (3) 客戶C總部位於中國內地，從事電子元件經銷。
- (4) 客戶D總部位於中國香港，從事電子元件經銷。
- (5) 客戶E總部位於中國內地，從事提供先進工業領域的技術服務，提供電子元件供應鏈服務及嵌入式系統解決方案。
- (6) 客戶F總部位於中國內地，從事為汽車電子和工業應用市場的客戶提供技術解決方案和半導體供應鏈增值服務。
- (7) 客戶G總部位於中國內地，從事系統集成、運維及技術諮詢與培訓業務。
- (8) 客戶H總部位於中國內地，從事充換電設施、通信設備及電腦軟硬件。

於往績記錄期，我們多數收入來自五大客戶(全部均為經銷商)。我們預計仍持續有大部分收入來自主要客戶。我們通常與主要客戶保持長期穩定的合作關係。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們與往績記錄期各年度的五大客戶並無任何糾紛。

下表載列於所示期間有關我們客戶群的若干關鍵運營指標。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
客戶數量 ⁽¹⁾	42	49	40
— 經銷商	36	44	35
— 直接客戶	6	5	5
客戶留存率(%) ⁽²⁾	71.2	81.0	71.4

附註：

- (1) 指有關期間與我們進行交易的客戶數量。
- (2) 按繼續於本年度／期間與我們進行交易的上年度／期間客戶數量除以上年度／期間的客戶總數計算得出。

我們於2023年、2024年及2025年分別有42名、49名及40名客戶。我們的客戶留存率在71.2%至81.0%之間波動，主要反映我們對經銷網絡的持續優化以集中資源。詳情請參閱「— 銷售、營銷及經銷 — 我們的經銷渠道 — 概覽」。

業 務

客戶及供應商重疊

於往績記錄期，我們的五大客戶（於往績記錄期各年度）中有兩名亦為我們的供應商。客戶C（我們於2023年的五大客戶之一）於往績記錄期各年度亦為我們研發活動所用耗材的供應商。我們於往績記錄期向客戶C採購的總額為人民幣8,200元（已扣稅）。客戶D（於2023年、2024年及2025年為我們的五大客戶之一）於2024年及2025年亦為我們研發活動所用耗材的供應商。我們於往績記錄期向客戶D採購的總額為人民幣13,900元（已扣稅）。根據弗若斯特沙利文的資料，公司同時向同一客戶／供應商進行銷售和採購符合行業慣例。我們向客戶C及客戶D採購的相關金額並不重大，合計佔我們於往績記錄期的採購總額不足0.01%。

於往績記錄期，我們向重疊客戶及供應商進行的銷售及採購並不相互關聯或互為條件。我們向上述重疊客戶或供應商採購的原材料並無轉售予彼等，反之亦然。我們向上述重疊客戶或供應商銷售及採購條款的協商，乃個別進行。就重疊供應商客戶而言，我們的銷售及供應協議的主要條款與其他客戶或供應商的條款大致相同，且符合市場慣例。董事確認，我們與上述重疊客戶或供應商之間的所有銷售及採購均在日常業務過程中根據一般商業條款及公平基準進行。除所披露者外，據我們所深知，我們於往績記錄期各期間的主要客戶並非我們的供應商，反之亦然。

知識產權

我們的專利、著作權、商標、域名、技術訣竅、專有技術、商業機密及其他知識產權對我們的業務運營至關重要。截至2025年12月31日，我們於境內獲授122項專利，包括102項發明專利及20項實用新型專利。截至同日，我們亦於海外（包括美國及日本）獲授45項專利，且就董事所深知，我們的所有海外專利屬有效及並無爭議。截至同日，我們於境內擁有160項軟件著作權及35項註冊商標以及於海外擁有10項註冊商標。我們亦已於中國及海外申請多項專利及商標。

我們通過自主開發獲得專利。截至最後實際可行日期，我們擁有我們所有的專利及專利申請，且並無與第三方共同擁有或共享我們的專利及專利申請的安排。

我們主要依賴專利、著作權、商標、商業機密及不公平競爭法律以及合同權利（例如保密協議）保護我們的知識產權。我們已在我們與員工及業務合作夥伴訂立的協議中清楚列明有關知識產權所有權及保護的所有權利及責任。此外，我們亦尋求透過維護我們物業的物理安全及信息技術系統的物理及電子安全，維護我們數據及商業機密的完整性及保密性。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何涉及侵犯知識產權進而可能對我們的業務造成重大不利影響的可能發生或尚未解決的糾紛。進一步詳情請參閱本文件「風險因素 — 有關我們業務及行業的風險 — 我們可能會因侵犯知識產權而遭到第三方索賠」。

業 務

質量控制

質量控制管理

身為fabless設計公司，我們已實施全面的質量保證制度，涵蓋整個芯片開發周期，包含設計、供應鏈監督、新產品引進(NPI)及量產。我們的質量管理框架獲ISO 9001認證，並與嚴格的車規級產品IATF 16949標準相符，確保我們始終向終端客戶提供可靠及出色的產品。

我們積極採納先進標準，以迎合嚴格的汽車及安全要求。我們其中一款主要產品已獲得ASPICE(汽車軟件過程改進與能力評定)第2級評定。此外，我們正積極將ISO 26262(汽車安全—功能安全)和ISO 27001(信息安全管理)標準融入我們的營運當中，加強我們對任務關鍵應用的安全及保障方面的承諾。

截至2025年12月31日，我們擁有五名專責質量控制人員，彼等具有高學歷及行業認證。全體成員持有「雙一流」大學或其他知名院校的學士或碩士學位。大部分成員於芯片開發行業均擁有超過五年的工作經驗。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何重大質量問題。

研發活動

在研發階段，我們實施嚴格的程序，作為品質控制架構的一部分。請參閱「— 研究及開發 — 研發流程」。我們組建由我們的研發及品質管理部成員組成的專業聯合研發品管團隊。該團隊首先將銷售和營銷團隊收集的客戶需求與我們的技術和解決方案相結合，制定項目計劃並進行可行性審查。之後，在芯片設計過程中，研發人員負責處理技術架構、算法和電路設計等工作，而品管人員則負責制定並執行嚴格的測試標準。其後，研發人員進行模擬、佈圖設計和驗證。同時，品管人員監督每個階段的全面測試，包括系統、參數和可靠性測試，確保產品符合內部和業界標準。這種結構化的合作方式讓我們能夠提供符合客戶需求的產品。

供應鏈質量控制

作為一家fabless公司，我們的質量控制延伸至外包製造合作夥伴。有關供應商篩選及評估標準的詳情，請參閱「我們的供應商— 供應商篩選及管理」。

在生產時，我們於製造流程的各個階段強制執行質量控制。我們的晶圓廠夥伴依照我們的設計精密製造芯片。芯片在進入封裝測試之前，會先經過嚴格的電路探測測試，以確保其功能和效能。封裝程序包括模切、接線和成型，以建立電氣連接，並為芯片提供物理防護。最終產品還要經過全面的功能、性能和可靠性測試，以確保符合設計要求。這些多重質量保證措施對維持客戶期望的高標準至關重要。

業 務

認證

我們有一整套功能安全程序，亦已就質量管理系統取得ISO9001認證、就環境管理系統取得ISO14001認證以及就職業健康及安全管理系統取得ISO45001認證。

退貨及質保

我們產品的質保視銷售產品的特性而定。我們在售後主動協助客戶解決任何品質問題。我們通常不允許客戶退貨或換貨，但客戶可以與我們協商因我們的過失而造成的瑕疵產品的退貨和賠償事宜。我們已根據客戶投訴處理程序制定標準的產品退換程序。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，(i)我們並無收到客戶的任何重大產品退貨、換貨、投訴或產品責任索賠；(ii)我們並無接獲任何有關產品質量的重大投訴；及(iii)我們並無經歷任何因重大產品缺陷而導致的產品召回或事故。

存貨

我們的存貨主要包括(i)原材料；(ii)庫存商品；(iii)委託加工物資；及(iv)半成品。請參閱「財務資料 — 節選資產負債表項目 — 存貨」。截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的存貨分別為人民幣73.1百萬元、人民幣114.8百萬元及人民幣161.3百萬元。

為維持我們的競爭力、使我們的產品與不斷變化的市場需求保持一致以及防止存貨過時，我們已實施措施優化存貨水平。我們主動追蹤市場狀況的變化，並維持安全庫存，以防預料之外的需求增加、供應延遲或短缺。我們會例行監控存貨，確保所有在途貨物得到有效管理。於2023年、2024年及2025年，我們的存貨週轉天數分別為192.3天、160.8天及188.4天。進一步詳情，請參閱「財務資料 — 節選資產負債表項目 — 流動資產／負債 — 存貨」。

信息安全及數據隱私

在業務過程中，我們收集、存儲並處理來自客戶、供應商及內部系統的數據，主要包括交易數據、技術數據和運行數據。數據所有權受與合作夥伴簽訂的協議規管，內部數據歸我們所有。由於我們僅與企業進行交易，故不會收集或處理個人數據。我們透過網絡與數據隔離、數據加密、安全數據管理協議以及嚴格的傳輸政策，以保護數據並降低數據安全風險。

我們已針對企業數據的使用、儲存和傳輸建立了全面的內部控制政策，涵蓋網路安全事故應變、客戶資訊管理和機密性。例如，我們已實施「客戶資訊管理政策」，透過明確的存取層級、防火牆及定期員工訓練來保護資料。此外，我們亦已實施網路與資訊安全政策，以控制硬件和資料的使用，要求僅能存取內部網路、監控軟件，以及任何資料傳輸均須經高級主管核准。只有獲得適當授權的員工方能在有必要知情的情況下存取敏感信息。作為僱傭條件之一，我們的員工必須簽署保密協議，該協議嚴格禁止未經授權披露任何與公司相關的機密資料。

業 務

我們維持健全的備份系統，將數據備份副本儲存在不同地點的本機和遠端，並定期測試數據還原程序，以確保在發生任何技術問題、自然災害或不可預見的情況時，可快速還原數據。對於跨境數據傳輸，我們根據業務需要，通過企業郵箱或指定FTP服務器等指定安全渠道向海外客戶及供應商傳輸交易和技術數據。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，本公司概無任何可能對我們業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的客戶機密資料外洩或任何其他客戶資料相關事故。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已在所有重要方面遵守與數據安全和隱私有關的適用法律法規，且根據我們的中國法律顧問，我們並無因違反網絡安全或數據隱私法律法規而面臨任何索賠或處罰，亦未發生任何相關事件。於往績記錄期，我們的絕大部分收入及營運均由我們位於中國的子公司進行，而我們的新加坡子公司尚未開展實質性營運或產生重大收入。因此，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們主要受中國相關網絡安全及數據安全法規的規管。

競爭

我們在競爭激烈且高度集中的產業中經營。我們與海內外同業在產品表現、技術創新及成本效率方面競爭。根據弗若斯特沙利文的資料，外國公司在全球市場佔有很大的份額。2025年，全球視頻橋接芯片市場呈現高度集中的競爭格局，前八大公司合計佔據約81.4%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，在視頻橋接芯片市場，我們為中國內地排名第一的fabless設計公司，市場份額為4.1%，而視頻橋接芯片是混合信號芯片的一個重要部分。

下表載列我們的產品與主要競爭對手的產品在主要規格、定價、應用及下游客戶方面的比較情況：

	本公司	競爭對手
智能視頻芯片		
— 視頻橋接	最高支持8K@60Hz，單通道12Gbps；兼容HDMI/DP/USB-C/MIPI/LVDS/VGA；組合接口(HDMI/DP、MIPI/LVDS)；集成MCU和CC控制器	最高支持4K@60Hz，單通道12Gbps；兼容HDMI/DP/USB-C/MIPI/LVDS/VGA；組合接口(HDMI/DP、MIPI/LVDS)；集成MCU和CC控制器
— 視頻處理	最高支持8K；局部調光、HDR、FRC、DSC、圖像縮放器、3D-LUT	最高支持8K；局部調光、HDR、FRC、DSC、圖像縮放器、3D-LUT
定價(美元)*	1.0-10.5	1.0-30.0
互連芯片		
— 高速信號	最高支持8Gbps	最高支持20Gbps
— AI運力	最高支持32GT/s（開發中）；兼容PCIe/CXL/SATA	最高支持32GT/s；兼容PCIe/CXL/SATA
— 車載SerDes	AEC-Q100（5種型號）；專有ADP協議	AEC-Q100（超過50種型號）；FPD-Link協議
定價(美元)*	0.2-8.7	1.0-35.0
應用	智能視覺終端、智能車載、AR/VR、AI & HPC	智能視覺終端、智能車載、AR/VR、AI & HPC

業 務

	本公司	競爭對手
下游客戶	消費電子OEM、汽車OEM及一級供應商、AR/VR設備製造商、電信設備製造商	消費電子OEM、汽車OEM及一級供應商、AR/VR設備製造商、電信設備製造商、雲服務提供商
成本控制	100%自主研發的IP已量產；ClearEdge設計重複使用(減少開發時間)；雙軌晶圓廠供應(國內外)	設計重複使用；平台級部署；長產品生命週期管理

* 根據往績記錄期的銷售額，按匯率(1美元=人民幣7元)估計。

與主流競爭對手相比，我們的產品通常具有更高的視頻分辨率視及更廣泛的相容性，可實現極致視覺體驗。此外，我們所有量產的晶片都是以自主研發的IP為基礎，將第三方授權成本降至最低。我們的ClearEdge平台能夠在200多種晶片型號中重複使用經過驗證的電路設計，並且只需最少的修改即可在晶圓廠節點間進行移植，從而降低了每項產品的開發成本。有關競爭格局的詳細分析，請見「行業概覽」。

員工

於往績記錄期，我們所有員工均位於中國。下表載列截至2025年12月31日按職能劃分的全職員工明細。

職能	人數	百分比
研發.....	192	75.0
行政.....	39	15.2
市場銷售	16	6.3
測試.....	9	3.5
總計.....	256	100.0

我們主要通過推薦、獵頭、招聘網站和校內招聘會等多種方式招聘員工。我們為員工舉辦入職培訓和定期在職培訓。我們與員工簽訂標準個人僱傭合同，涵蓋薪資、獎金、福利、保密義務、競業禁止條款、工作產品及知識產權轉讓條款及合同終止理由等。我們一般與若干主要經理及專業人士訂立不競爭協議，其一般包括於受僱期間及離職後仍然生效的保密義務以及於受僱期間及終止受僱後最長兩年內可予執行的競業禁止條款。

員工可獲工資和獎金，其按資歷、績效評估及工作年期而定。我們亦提供股權激勵和晉升機會。我們致力於為員工提供安全的工作環境及職業發展機會。

根據中國法律法規的規定，我們參與多項政府法定員工福利計劃，包括社會保險計劃，即養老、醫療、失業、工傷及生育保險計劃以及住房公積金。於往績記錄期及截至最後實際可行日期，我們根據若干員工的實際工資為其全額繳納住房公積金，但並

業 務

未全額繳納社會保險。於2023年、2024年及2025年，社會保險供款不足額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣3.9百萬元。

據我們的中國法律顧問告知，根據適用的中國法律法規，社會保險供款不足可能導致我們須繳納每日逾期金額0.05%的滯納金，若未在規定期限內支付，主管機關可處以逾期金額一至三倍的罰款。根據上述供款不足額，於2023年、2024年及2025年，潛在最高罰款金額分別約為人民幣6.9百萬元、人民幣9.0百萬元及人民幣11.7百萬元。有關適用的中國法律法規的詳情，請參閱「監管概覽—就業、社會保險及住房公積金相關法律法規」。

據我們的中國法律顧問告知，倘(i)適用法律、法規及當地執法及監管政策並無重大變動，及(ii)並無出現大規模的員工投訴、訴訟或仲裁，我們因有關供款不足而面臨主動追繳或處罰的風險極低。此外，我們的控股股東已承諾，若有關當局要求我們清繳少繳的款項，彼等將對我們可能招致的任何付款、罰款或損失作出全額賠償。基於上述情況，我們於往績記錄期並無為社會保險供款的不足作出撥備。

我們的員工目前並無工會代表。我們認為，我們與員工的合作關係良好，而我們於往績記錄期直至最後實際可行日期的營運並無遇到任何重大勞資糾紛、罷工、抗議或招聘員工方面的困難。

物業

我們的總部位於安徽省合肥市，並於中國就我們的業務運營擁有及租賃若干物業。截至2025年12月31日，我們並無單一物業的賬面值佔我們總資產15%或以上，因此毋須根據上市規則第5.01A條於本文件內載入任何估值報告。根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條有關公司(清盤及雜項條文)條例附表三第34(2)段的規定，其要求就我們所有土地或房屋及建築物權益提供估值報告。

自有物業

土地

截至最後實際可行日期，我們有權於中國使用一幅地塊的權利，總佔地面積約29,100平方米，主要用作研發中心。截至最後實際可行日期，我們已就地塊取得有關土地使用權證，而我們並無接獲任何來自第三方對該地塊的所有權爭議申索。

業 務

房屋及建築物

截至最後實際可行日期，我們於中國擁有55項物業，包括六幢房屋及建築物及49個停車位，總建築面積約為12,100平方米，主要用作研發中心及辦公場所，我們已取得所有自有物業的房屋所有權證。

租賃物業

截至最後實際可行日期，我們於中國各地租賃10項物業，總建築面積約為1,500平方米，主要用作研發、辦公室及員工宿舍。

截至最後實際可行日期，我們尚未就位於中國的一項租賃物業完成租賃登記備案，總建築面積約為28平方米，主要由於難以促使相關業主配合登記租賃。此物業用於內部餐飲。截至最後實際可行日期，就尚未完成租賃登記或租賃登記修訂的租賃物業而言，相關當地房地產管理部門並無要求我們完成登記，亦無對我們施加處罰或罰款。誠如我們的中國法律顧問所告知，未進行登記手續將不會影響租賃協議的有效性，亦不會對我們的業務造成重大不利影響。

保險

我們根據相關法律法規及我們對運營需求和行業慣例的評估投購保險。我們為於中國工作的員工提供社會保險，包括養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險和失業保險。我們亦為退休返聘人員及兼職員工投購商業保險(包括人身意外險及僱主責任險)及為我們擁有的汽車投購車險。

根據一般市場慣例，我們並無投購中國法律未強制規定的任何業務中斷險、主要人員人壽險或覆蓋我們的網絡基礎設施或信息技術系統的損壞險。請見「風險因素 — 我們可能未投保足額保險以覆蓋潛在的責任或損失」。我們相信，我們現有的保險範圍足以涵蓋我們的業務運營。

環境、社會及管治

ESG管治

ESG管理與目標

我們始終將環境、社會及管治(ESG)管理視為我們長期穩健發展的戰略優先事項，並已將ESG理念融入我們的管治架構和業務決策。

在ESG管治方面，我們已建立由董事會、戰略委員會和ESG工作小組組成的三層管理架構。董事會為我們ESG事務的最高決策機構，負責審核和批准我們的ESG戰略規劃和相關工作計劃、ESG管治框架、政策和ESG報告。戰略委員會為我們的管理層組織，

業 務

負責監督ESG相關趨勢和政策發展、監督和評估ESG工作的實施情況，並就ESG事務向董事會提出建議。ESG工作小組實施ESG策略、編製ESG報告、組織培訓及向戰略委員會匯報。

產品責任

我們遵守《中華人民共和國產品質量法》及《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規。我們已建立《芯片設計流程》、《代工廠管理規範》、《合規性評價管理流程》、《生產件批准程序》及《售後服務規定》等內部政策，覆蓋立項、設計、生產、出貨及售後。有關我們的質量控制流程詳情，請參閱「— 質量控制」。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，概無任何有關產品質量的客戶投訴記錄。

我們制定了《知識產權管理流程》及《顧客財產管理程序》，分類管理技術文檔、客戶資料及合作信息，並通過保密協議強化信息安全。我們亦制定了《綠色產品控制程序》，以識別及控制產品環保屬性，確保符合國家及客戶環保標準。

員工發展

我們制定並執行《人力資源管理制度》、《員工行為管理規範》和《福利管理制度》等內部制度，確保招聘、僱用及職業發展等工作的規範化管理。有關我們的員工招聘及薪酬詳情，請參閱「— 員工」。我們堅持平等就業的原則，確保在招聘、晉升或薪酬等方面不存在性別、種族、宗教或婚姻狀況等歧視。在培訓及發展方面，我們建立了一套系統化的架構，包括入職培訓、特定工作技能培訓以及多層次的管理能力提升。

職業健康與安全

我們已建立工作場所安全與職業健康管理制度，列明辦公環境的安全和衛生要求，並概述管理員工職業健康的基本程序。我們依照法律規定，定期為員工組織健康檢查。此外，我們通過辦公系統和會議傳播安全 and 健康信息，提高員工的自我保護和安全意識。我們已就職業健康及安全管理系統取得ISO 45001認證。請參閱「— 質量控制 — 認證」。

可持續供應鏈

我們實施了內部政策，例如《供應商選擇、評估與管理程序》和《封裝測試外包管理程序》，以規範供應商准入、評估及持續監督。有關詳情，請參閱「— 供應鏈管理」。

業 務

社區貢獻

我們積極履行企業社會責任，秉持「以實際行動回饋社會」的原則。我們持續捐助宣城市寧國燕津教育基金會，旨在改善農村學校的教學條件，為農村學校的學生提供支持。於2023年，我們捐款人民幣1.0百萬元，為農村學生提供免費午餐、提供助學金及改善學校設施。於2024年，我們再次向同一基金會捐款人民幣500,000元，促進農村學生的全面發展。

反腐敗

在遵守相關法律法規的同時，我們堅持誠信和規範經營的原則。我們已實施《誠信廉潔管理制度》，明確員工在執行職務時的行為要求和禁止行為。我們大部分員工已在入職時簽署《誠信自律承諾書》，並在入職期間接受系統的反腐敗和職業道德培訓。此外，我們建立了包括政策制定、流程監督和問責等環節的反腐敗控制體系。我們進行內部稽核、合規性檢查和制度審查，以識別關鍵職位和業務流程中潛在的誠信風險。此外，我們設立包括電子郵件、書面信函和面談等多種舉報和投訴渠道，保障舉報人的信息安全和合法權益。對於高風險職位，我們加強事前審批和流程審查機制，將誠信要求納入部門管理和績效考核。此外，我們推動定期的反腐敗培訓，並針對管理層和董事會開展專門課程。截至2025年12月31日，我們未收到任何腐敗行為的舉報，也未涉及任何與腐敗或賄賂相關的訴訟。

綠色經營

環境管理及目標

作為一家fabless芯片設計公司，我們主要從事研發和辦公室活動。因此，我們在營運期間對環境的影響相對較低。我們的環境管理措施涵蓋辦公室和研發活動的能源效率、無紙化辦公及資源節約以及廢棄物分類、減量和回收。有害廢棄物由合格實體按照《固體廢棄物管理條例》處理。於往績記錄期，本公司的資源消耗、廢棄物產生量及排放量並未出現重大波動。

以2025年為基準年，我們制定涵蓋能源、水資源、廢棄物和溫室氣體排放的階段性環保目標：

- **能源**：到2026年，我們的綜合能源消耗強度將較2025年減少2%。
- **水資源**：到2026年，我們的用水強度將較2025年減少2%，同時達到100%的廢水排放達標率。
- **廢棄物管理**：到2026年，我們將維持100%的廢棄物合規處置率。
- **溫室氣體排放**：到2026年，我們的溫室氣體排放強度將較2025年減少2%。

業 務

應對氣候變化

我們積極響應全球氣候治理倡議，將低碳與可持續發展原則融入研發、供應鏈協作及日常營運管理的各個層面。

我們識別了氣候變化所帶來的產品與市場以及融資兩項主要機遇：

機遇類型	機遇	潛在影響	應對措施
產品與市場	低碳產品與服務	對高效率、低損耗、高速互連芯片的需求增長，強調系統級節能	持續優化信號傳輸架構與芯片設計，提升系統能效及減少下游能耗；推動產品在能效與可靠性方面的標準化認證
融資	綠色金融支持	綠色產業導向為具備節能、能效優化能力的企業帶來綠色信用、低碳基金及可持續投資機會	加強供應鏈減碳協作，提升公司在綠色金融體系中的信用評級，積極參與綠色項目與可持續融資渠道，吸引負責任投資者

根據中國生態環境部頒佈的《企業溫室氣體排放核算與報告指南(2022年修訂版)》、《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》以及《溫室氣體議定書：企業會計與報告準則(2021)》，我們已建立了一套溫室氣體排放管理框架，涵蓋排放源分析和識別到數據收集、核算和測量以及目標設定的全過程。從排放源識別的角度來看，作為一家fabless半導體公司，我們的溫室氣體排放主要來自非製造業的營運活動。我們的範圍1溫室氣體排放主要包括使用公司車輛所產生的直接排放。我們的範圍2排放主要包括辦公室運營中外部購買的電力和用水所產生的間接排放。我們的範圍3排放包括在業務活動過程中產生的其他間接排放，包括與我們的產品、員工和其他價值鏈相關活動有關的排放。

根據確定的排放源，我們進行了全面的碳盤查和統計評估，並測量了我們的溫室氣體排放量。於2025年，我們的溫室氣體排放總量為7,898.6噸二氧化碳當量，其中包括6.9噸範疇1排放、875.8噸範疇2排放和7,015.8噸範疇3排放，每百萬人民幣收入的溫室氣體排放強度為13.9噸二氧化碳當量。根據弗若斯特沙利文的資料，不同公司披露範圍3溫室氣體排放的統計範圍不同，在披露方法與本公司類似的公司中，即涵蓋價值鏈上

業 務

下游全生命週期的公司中，溫室氣體排放強度水平一般在每百萬人民幣收入10至20噸二氧化碳當量之間，表明我們的排放強度符合行業標準。

範圍1排放量主要與公司車輛有關，於往績記錄期並無重大波動，僅有輕微增加，主要由於公司車輛使用頻率較高，與我們的日常業務運作相符。範圍2排放量主要來自辦公及研發區域使用的外部採購電力和水，由2023年的553.6噸二氧化碳當量增加至2025年的875.8噸二氧化碳當量，主要是由於我們的業務擴張、員工人數增加、辦公及研發活動頻率提高，導致辦公場所、研發設備、測試設備、服務器、照明及空調系統的用電量增加。範圍3排放量主要涉及員工出差以及我們產品的上下游生命週期排放。作為一家fabless芯片設計公司，我們的直接營運排放仍然有限，而我們的溫室氣體排放的很大一部分是間接來自與我們產品相關的價值鏈活動。於往績記錄期，範圍3的排放量由2023年的3,697.5噸二氧化碳當量增加至2025年的7,015.8噸二氧化碳當量，是我們溫室氣體排放總量增加的主要因素。這主要是由於我們產品銷售量的增長以及價值鏈活動的相應增加所致。具體而言，隨著我們產品銷量的增加，我們對外包晶圓製造、封裝測試服務、物流及其他產品生命週期相關活動的需求亦隨之增加，這些上游和下游活動所產生的溫室氣體排放被計入範圍3排放。考慮到往績記錄期我們的溫室氣體排放強度相對穩定，我們的溫室氣體絕對排放量增加主要是由於我們的業務規模擴大、產品銷量增長及相應的外包生產和價值鏈活動增加所致，而非我們的排放效率大幅下降。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
溫室氣體排放量			
（噸二氧化碳當量）.....	4,255.1	5,811.9	7,898.6
範圍1—直接溫室氣體排放量			
（噸二氧化碳當量）.....	4.0	5.2	6.9
範圍2—間接溫室氣體排放量			
（噸二氧化碳當量）.....	553.6	646.7	875.8
範圍3—其他間接溫室氣體排放量			
（噸二氧化碳當量）.....	3,697.5	5,160.0	7,015.8
溫室氣體排放強度（噸二氧化碳當量／			
人民幣百萬元收入）.....	13.2	12.5	13.9

基於上述碳清單結果，我們進行了有針對性的數據分析，並以2025年為基準年制定了分階段的減排目標。根據弗若斯特沙利文的資料，我們所採用的方法和目標設定方式與業界的普遍做法一致。我們的短期目標為於2026年前將溫室氣體排放強度降低2%，中長期目標為於2030年前降低10%。

展望未來，我們將強化溫室氣體排放管理體系，逐步建立碳排放監測與信息披露機制，推行節能改造及綠色辦公措施。

業 務

廢棄物管理

我們遵守國家和地方的相關規定，制定了《固體廢棄物管理規定》。這些規定規範廢棄物分類、收集、儲存和處置。在日常營運中，我們主要產生辦公室廢棄物、電子廢棄物和少量有害廢棄物。我們採用「源頭分類、定點處置、統一清運」的機制。在辦公室區域放置分類容器，定期委託合格機構進行回收清運，確保廢棄物得到妥善處理。對於廢棄電腦、服務器和電子零件等電子廢棄物，我們委託專門機構進行規範化拆解處理。

研究和測試活動中產生的廢棄化學品、實驗樣品和相關包裝均存放在專用的密封容器中，並以定期登記和移除的方式進行監控，由持有有害廢棄物經營許可證的第三方機構按照監管規定進行無害化處理。我們對有害廢棄物的管理進行全面的記錄和台賬檢查，以確保數據的真實性和可追溯性。

於2023年、2024年及2025年，我們的廢棄物合規處置率達到100%，於往績記錄期廢棄物產量並無重大波動。在此基礎上，我們以2025年為基準年，制定了階段性管理目標，要求到2026年及2030年，一般廢棄物和有害廢棄物的合規處理率均保持在100%。具體而言，對於研究和測試活動中產生的有害廢棄物，我們的目標是確保100%的有害廢棄物由持有有害廢棄物經營許可證的合格第三方機構處理，並有登記記錄和管理台賬，以確保其可追溯性。我們亦將配合日常營運，持續推動辦公室廢棄物的源頭分類、回收與減量。

資源管理

我們能源消耗主要來自辦公與研發活動中的電力使用。2025年，能源消耗總量為378.5噸標準煤，能源消耗強度為0.7噸標準煤／人民幣百萬元收入。我們通過採用LED燈具、優化空調設定及節能培訓等措施致力降低能源消耗。

我們日常用水主要來自於辦公與研發活動。2025年，全年水資源消耗總量為2,506.5立方米。我們通過實行感知式水龍頭和定期檢測供水系統減少用水浪費。

於往績記錄期，我們的總能源消耗增加主要是由於外部採購電力消耗增加所致。隨著我們的業務擴張，我們的員工人數增加，研發項目、辦公室營運及測試相關活動的數量及頻率相應增加，導致辦公場所、研發設備、測試設備、服務器、照明及空調系統的用電量增加。作為一家fabless芯片設計公司，我們並無經營能源密集型的生產設施，因此能源消耗的增加主要是由於我們辦公室及研發活動的擴張，而非我們業務模式的任何重大改變所致。我們的能源消耗強度於往績記錄期維持相對穩定，顯示總能源消耗的增加主要是由於我們的業務規模增長，而非能源效率的嚴重惡化所致。

業 務

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
水資源消耗總量(立方米)	2,697.6	2,453.6	2,506.5
能源消耗總量(噸標準煤)	237.2	279.4	378.5
能源消耗強度(噸標準煤／ 人民幣百萬元收入)	0.7	0.6	0.7

我們以2025年為基準年，制定了階段性資源消耗目標。到2026年，我們的目標是能源消耗強度和用水強度較2025年降低2%；到2030年，我們的目標是能源消耗強度和用水強度均較2025年降低5%。為實現這些目標，我們將繼續優化辦公及研發區域的用電，推廣節能照明及設備，改善空調管理，加強員工意識培訓，並定期對供水系統進行檢查。

法律訴訟及合規情況

法律訴訟

我們可能不時涉及在日常業務過程中產生的各類法律、仲裁或行政訴訟。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們未曾及並未捲入任何可能對我們的業務、財務狀況和經營產生重大不利影響的法律、仲裁或行政程序，亦不知悉任何針對我們或董事的未決或構成威脅的法律、仲裁或行政程序，而該等法律、仲裁或行政程序可能個別或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。請見「風險因素 — 我們面臨與訴訟和糾紛有關的風險，這可能對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生不利影響」。

截至最後實際可行日期，我們正與李高峰先生（「李先生」）存在一宗勞資糾紛訴訟。李先生曾任深圳朗田畝行政助理，於2020年7月離職。李先生的過往要約文件的購股權條文規定，李先生將於五年期間內相關週年完成時獲授本公司若干購股權。過往要約文件條文較為籠統及概念性，缺乏執行及履行的具體條款。然而，李先生聲稱有權根據該要約獲得購股權。於2023年4月，李先生提請仲裁，索償約人民幣10.6百萬元，該仲裁申請遭駁回。李先生隨後向深圳法院提起訴訟，並將索賠金額提高至人民幣100.0百萬元。於2025年11月，一審法院駁回李先生全部訴求。李先生已提出上訴，並已進入二審程序。二審法院已就案件進行聆訊。截至本文件日期，案件仍在審理中，尚未作出判決。

我們的中國法律顧問認為，本集團於訴訟中取得不利裁決並須承擔所索賠損害賠償的風險甚微，鑒於：(a)根據廣東省深圳市龍崗區人民法院頒佈的民事判決書，由於過往要約文件所載購股權相關條文並無訂明行使價、歸屬條件及行使期等必要條款，因此該等條文並不構成法律上可強制執行的協議；及(b)過往要約文件並無規定李先生有權將所聲稱的任何購股權轉換為現金。

業 務

此外，我們的控股股東陳先生已承諾就本次爭議所產生的任何損失向本公司作出彌償。因此，我們認為此爭議不會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響，故未就此爭議作出任何撥備。根據我們中國法律顧問的意見及陳先生提供的彌償保證，董事認為此爭議不會對我們的業務營運及財務表現造成重大不利影響。根據中國法律顧問的意見、陳先生提供的彌償承諾、董事的意見以及其已進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並未發現任何足以使其不同意董事對該爭議所持觀點的事項。據我們的中國法律顧問所告知，除與李先生的爭議外，截至最後實際可行日期，概無現有或前員工對本集團提起類似訴訟。

合規

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面遵守適用於我們營運的所有相關法律法規。於同期，據我們的中國法律顧問所告知，我們未因嚴重違反適用法律法規而受到相關監管機構的任何行政處罰。有關適用於我們的法律法規的更多資料，請見「監管概覽」。

風險管理及內部控制

我們已制定及實施有關我們業務運營、財務報告及一般性合規的風險管理政策及內部控制措施。

內部控制制度

我們的風險管理政策涵蓋運營的所有主要方面。董事會審計委員會負責監察風險管理及內部控制。我們的高級管理層團隊及內部審計部門負責這些內部控制程序的日常執行。我們亦定期檢討我們的政策及程序，以確保符合監管要求及業務目標。

財務報告風險管理

我們的會計政策涵蓋金融資產管理、預算及財務報表編製以及會計記錄管理。我們實施多層審查機制，包括職責分工、審批層級和自動化會計系統，以提高財務數據的完整性。為防止欺詐性報告，我們的財務部門定期進行內部審計及委聘獨立外部核數師評估財務報告風險。財務部門亦評估內部控制，監督會計政策的遵守情況，並確保財務披露的透明度。此外，我們採用先進的數據安全措施保護財務數據免受未經授權的訪問和網絡威脅。

信息系統及數據安全風險管理

為防止數據洩漏和丟失，我們實施了結構化的IT治理框架管理網絡安全風險、數據隱私和系統可靠性。我們的核心業務系統包括OA、ERP、CRM、BI、SMES及其他IT系統，這些系統已融為一體，確保數據流和運營效率。我們的數據保護政策旨在防止未

業 務

經授權的訪問及保護敏感信息。有關我們的信息系統及數據安全措施詳情，請參閱「— 信息安全及數據隱私」。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並未遇到任何重大數據洩露、信息丟失或網絡安全事件。

合規風險管理

我們已實施嚴格的內部程序，以確保我們的運營遵守適用法律法規。我們的法律團隊關注監管框架的變化，並對我們的內部政策和程序作出必要的調整。我們於與客戶、供應商或第三方訂立合同前會進行全面的盡職審查。我們的合規框架包括定期培訓計劃、內部審計和監控，以確保遵守相關法律和公司政策。有關我們的合規及反貪污培訓以及舉報機制，請參閱「— 環境、社會及管治 — 反腐敗」。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，並無發現重大合規問題或違規行為。

證書、批准及許可

我們必須取得或維持各種證書、許可及批文，才能經營我們的業務。我們相信，我們已從相關政府機關取得對我們在中國及境外的業務營運至關重要的所有必要證書、批准及許可。經我們的中國法律顧問告知，於整個往績記錄期及截至最後實際可行日期，我們已自相關政府機關取得對我們境內的業務營運而言屬重大的所有必要證書、批准及許可。我們須不時重續有關證書、批准及許可，且我們持續監察有關法律法規的合規情況。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們在重續證書、批准及許可方面並無遭遇任何重大困難，且目前我們預期此類重續不會出現任何重大困難。

下表載列我們截至最後實際可行日期重要的證書、批准及許可。

持有人	證書／批准／許可	頒發／備案機構	有效期
本公司.....	報關單位備案證明	中華人民共和國廬州海關	永久
深圳朗田畝	報關單位備案證明	中華人民共和國福中海關	永久

獎項及認可

下表呈列我們獲得的主要獎項及認可。

獎項／認可	獲獎年度	頒發機構／機關
國家重點鼓勵的集成電路設計企業.....	2021年	國家發展改革委、工信部、財政部、海關總署、稅務總局

業 務

獎項／認可	獲獎年度	頒發機構／機關
高新技術企業	2023年	安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、 國家稅務總局安徽省稅務局
安徽省研發強度百強企業	2023年	安徽省科技廳、安徽省統計局
科創板價值50強	2025年	中央廣播電視總台上海總站、中央廣 播電視總台財經節目中心及申萬宏 源證券研究所

美國關稅的影響

由於我們並未直接向美國出口產品，且未來亦無計劃開展有關出口業務，因此美國關稅政策的變動對我們於往績記錄期及截至最後實際可行日期期間的業務營運及財務表現僅產生極微小的直接影響。

由於我們與經銷商之間為買賣關係，且我們在美國並無任何經銷商，因此經銷商將我們的產品轉售至美國市場之任何行為均由該等經銷商自行決定，且我們並無指示或控制產品銷售後之最終目的地。此類跨境交易中的關稅及相關責任僅屬於經銷商與其各自客戶之間的合約事宜，不會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成任何重大不利影響。

儘管上文所述，倘經銷商、終端客戶或供應鏈的其他參與者將我們的產品轉售至美國市場，或將產品整合至其後銷售至美國市場的製成品，美國關稅或貿易政策的變動可能會增加該等產品或製成品的成本，降低其於美國市場的競爭力，或以其他方式影響該等經銷商、終端客戶或供應鏈參與者的採購決策、庫存規劃、需求預測或整體業務表現。因此，其對我們產品的需求可能受到不利影響，從而間接影響我們的業務。

然而，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無收到經銷商要求我們承擔、補貼或償付美國進口關稅的任何索賠或要求，亦無遇到因美國關稅政策或相關貿易措施變動而導致的重大訂單取消、供應鏈中斷或經營中斷。

此外，本集團過往曾採購若干源自美國的設備，該等設備在出口、再出口或轉讓至中國境內，或於中國境內轉讓時，均無須遵守BIS任何許可要求。在2025年期間，美國政府根據《國際緊急經濟權力法》（「IEEPA」）宣佈對來自中國的進口商品徵收多輪關稅，而中國則相應調整適用於若干美國原產進口商品的關稅率。儘管如此，本集團對相關

業 務

美國原產設備的採購已於2024年完成。自2025年起，本集團未再採購任何美國原產設備，因此並未因中美關稅政策變動而產生額外關稅成本，亦未遭受任何重大不利影響。

因此，我們的國際制裁法律顧問認為未來美國關稅政策的變動對我們的業務營運、財務表現及長期發展前景的潛在影響仍維持有限。我們將密切關注美國關稅及相關國際貿易政策的後續變動，及時評估對本集團的潛在影響，並調整業務策略以將任何潛在不利影響減至最低。

美國出口管制及國際制裁的影響

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們於芯片設計活動中採購並使用若干源自美國的設備、軟件及獲授權知識產權，包括協議分析器和電子設計自動化軟件。因此，我們的產品銷售可能受EAR下的《外國直接產品規則》所規範，該規則限制與特定對象進行交易，例如實體清單上所載列附註標示的實體，以及位於若干受制裁司法管轄區（例如俄羅斯、白俄羅斯或伊朗）的實體。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無亦無意從事任何有關受限制交易。於同期，我們並未直接向美國或任何全面受制裁的司法管轄區出口產品。

另外，自2022年10月起，BIS實施EAR第744.6(c)條的管制措施，限制美國人士在未經授權的情況下，支持若干位於中國的半導體製造設施開發或生產若干「先進節點集成電路」。「先進節點集成電路」包括EAR第772.1條所界定的邏輯和記憶體集成電路。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們主要從事以成熟工藝節點為基礎的集成電路的研發和設計，並無營運半導體晶圓生產廠。近期，我們正致力設計一款將透過多項目晶圓工藝生產的芯片，其符合EAR中對「先進節點集成電路」的定義。此外，我們的執行董事、董事長兼總經理陳先生為美國人士及本集團的核心技術人員，主要負責監督本集團的整體營運、管理、企業管治及戰略規劃（包括高階技術計劃）。陳先生並無參與本集團集成電路產品相關的日常設計、開發、驗證、製造或生產活動。

我們的先進節點集成電路目前處於研發及原型測試階段。此類集成電路並非為AI訓練應用而設計或預定，且根據其預期技術參數及預定應用，預計不會被歸類於EAR的ECCN 3A090.a項下，亦預計不會受到適用於先進運算集成電路的最嚴格出口管制要求所規範。基於此類產品的當前開發狀況及迄今為止進行的相關交易的性質，我們預計目前與先進節點集成電路相關的活動，並不構成對位於若干中國境內半導體製造設施開發或生產若干先進節點集成電路的支援。基於上述理由，誠如我們的國際制裁法律顧問所告知，陳先生身為美國人的身份，並未對我們的營運產生任何額外的BIS許可要求，亦不會對我們在往績記錄期及截至最後實際可行日期遵守適用的美國出口管製法律及法規造成不利影響。

業 務

經審閱往績記錄期至最後實際可行日期期間的相關交易資訊(包括在可取得範圍內，關於我們經銷商下游客戶的資訊)，我們的國際制裁法律顧問認為，我們於往績記錄期至最後實際可行日期期間的交易，並未構成違反適用之美國出口管制法律及法規或相關國際制裁制度。據此，我們的董事認為，我們的業務活動(包括陳先生參與本集團營運)符合美國的適用出口管制法律法規及相關國際制裁制度，且有關制度並未，將來亦不太可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

為監察監管發展，並降低與國際制裁及出口管制相關的潛在風險，本集團已實施並持續強化以下合規措施：

- (a) 交易對手篩查控制。本集團已實施內建於銷售流程的貿易合規控制系統，需於交易生命週期的多個階段對客戶及其他交易對手進行制裁篩查，並向相關業務人員提供交易特定的合規指引。
- (b) 合規審查與風險分類機制。本集團已採納交易對手方分類及分級管理的內部指引，其中載列標準化審查程序、界定風險分類標準，以及相應緩解或升級措施。
- (c) 監管監測。本集團聘請外部出口管制及制裁顧問，以監測適用制裁及出口管制機制的發展，並定期提供相關國際及地區監管變動的最新資訊。

美國對外投資規則的影響

我們從事集成電路設計業務。經國際制裁法律顧問評估，我們的芯片設計活動僅符合最終規則中須申報等級的「受關注活動」範圍，因：(i)我們的高速混合信號芯片(主要設計用於數據連接及傳輸應用)有別於C.F.R.第774部分補充第1至第15號ECCN 3A090.a項所規範的高效能運算芯片(其基於「總計算能力」及「性能密度」的特定門檻控制若干集成電路，及(ii)我們的芯片並非設計用於4.5開氏度或以下溫度運作。因此，國際制裁法律顧問認為，根據最終規則，我們屬於「受關注外國人」範疇，美國人士的投資行為(包括收購我們的非公開發行股份)可能須遵守申報要求。

然而，根據美國財政部於2025年12月23日頒佈的最終規則常見問題(X.4)規定，於並無其他特殊情況下，當美國人士取得受關注外國人的股權時，若該股權於收購當下屬公開交易證券，則該證券符合最終規則項下「公開買賣證券例外」的定義。因此，據我們的國際制裁法律顧問所告知，美國投資者收購我們於聯交所公開買賣的股權時可豁免申報要求，惟該投資所賦予的權利超出標準少數股東的保護範圍者除外。

業 務

據此，我們的董事及國際制裁法律顧問認為，最終規則預期不會對我們的證券於交易所的[編纂]造成重大不利影響。我們及國際制裁法律顧問均未就最終規則的合規事宜向[編纂]提供建議。任何[編纂]倘對最終規則是否適用於其參與[編纂]認購股份存有疑問，應諮詢其自有法律顧問。

此外，由於董事長為美國人士，且我們根據最終規則的申報要求屬於「受關注外國人士」，我們的國際制裁法律顧問認為，在下列情況下，最終規則下的通知規定將會適用。若陳先生就我們進行任何屬於C.F.R.第31卷第850.210條範圍內的交易，且該交易既不適用C.F.R.第31卷第850.501條所規定的豁免交易條文，亦不適用C.F.R.第31卷第850.502條所規定的國家利益豁免，則根據最終規則，該交易將導致陳先生須履行通知規定。